

KAIST IDEC

시스템반도체설계 실무인력양성사업

컨소시엄 기업 소개

(37개사, 2023.02.20 기준)



- 목 차 -

컨소시엄 기업(37개사)

1. 가온칩스 -----	1	21. 이미지스테크놀로지 -----	42
2. 네메시스 -----	3	22. 자람테크놀로지 -----	44
3. 네오와인 -----	5	23. 지니텍스 -----	46
4. 넥스트칩 -----	7	24. 칩스앤미디어 -----	48
5. 동운아나텍 -----	9	25. 커넥스트 -----	50
6. 라닉스 -----	11	26. 코아시아 -----	52
7. 락온텍 -----	13	27. 쉐리타스반도체 -----	54
8. 램십 -----	15	28. 큐버모티브 -----	56
9. 보스반도체 -----	17	29. 테크워드유 -----	58
10. 브이에스아이 -----	19	30. 텔레칩스 -----	60
11. 세미파이브 -----	21	31. 파이칩스 -----	62
12. 스카이칩스 -----	23	32. 픽셀플러스 -----	64
13. 실리콘아츠 -----	25	33. 하이덱 -----	66
14. 쓰리에이로직스 -----	27	34. 사이언티픽아날로그랩스 -----	68
15. 아이닉스 -----	29	35. 하만커넥티드서비스즈 -----	70
16. 아이언디바이스 -----	32	36. 퓨처디자인시스템 -----	72
17. 어보브반도체 -----	34	37. 레이언스 -----	74
18. 오픈엣지테크놀로지 -----	36		
19. 원세미콘 -----	38		
20. 유엑스팩토리 -----	40		



01

(주)가온칩스

www.gaonchips.com



■ 회사 개요



회 사 명 : 주식회사 가온칩스 (GAONCHIPS Co., Ltd.)

대표이사 : 정 규 동

설 립 일 : 2012 년 08 월 06 일

상 장 일 : 2022 년 05 월 20 일 KOSDAQ 상장

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 번길 35, 판교 실리콘 파크 B 동 6 층

임직원수 : 149 명 (2022 년 8 월)

주요사업 : Total Solution (PSI, SoC Platform, IP Hardening, Optimized Design Solution)

매 출 액 : 322 억 3,560 만 (2021 년 12 월 IFRS 개별)

홈페이지 : www.gaonchips.com

■ 회사 소개

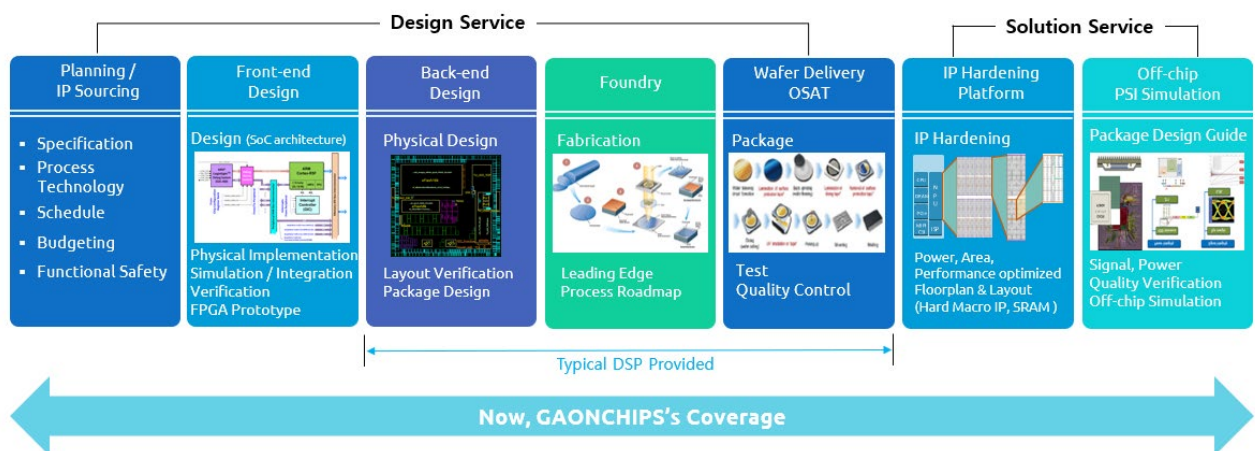
시스템반도체 밸류체인의 중심, No.1 디자인 솔루션 파트너 가온칩스



2012 년 설립된 가온칩스는 시스템 반도체 개발 및 생산을 위한 초기 IP 소싱부터 최종 패키지 설계와 제품의 신호 품질 확보 솔루션까지 고객이 필요한 모든 공정에 대한 토탈 솔루션을 제공하는 디자인 솔루션 No.1 기업입니다.

가온칩스는 삼성 파운드리와 Arm 의 베스트 디자인 솔루션 파트너로서, 파운드리 공정 기술에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 설립 후 현재까지 약 300 건의 프로젝트를 성공적으로 수행 하였습니다. 특히 차량용 반도체와 인공지능(AI) 반도체를 기반으로 하이엔드 공정에 최적화된 솔루션을 구축하여 차별화된 기술력과 우수한 비즈니스 실적을 토대로 시스템반도체 핵심 산업분야의 다양한 고객사와 가치 창조를 목표로 함께 성장하며 시장을 선도하는 첨단 기술력으로 시스템반도체 중심으로 나아가고 있습니다.

■ Technical Solution



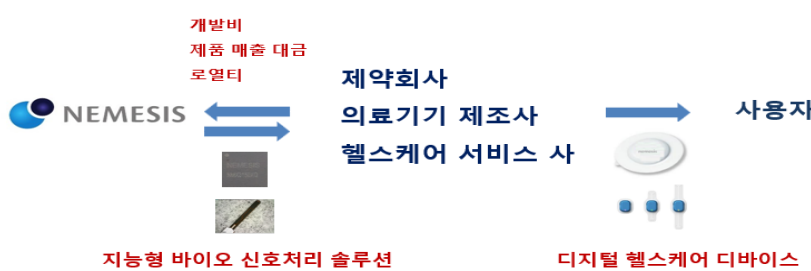
■ 복리후생

 유연근무제 운영 (자율출퇴근, 재택근무, 시차출근)	 청년(재직자)내일채움공제 가입 지원	 각종 포상제도 운영 (Best엔지니어상, 특별성과상 등)	 워크숍 및 야유회 (체육대회 운영)
 장기근속 휴가 제도 운영	 리프레시 휴가 제도 운영	 명절 부모님 용돈 지원	 자녀 학자금 지원
 교육 및 교육비 지원	 전월세 자금 지원	 종합건강검진 지원	 사내 동호회 운영
 자녀 출산 축하금 지원	 경조사 지원 및 상조용품 지원	 인재추천 장려금 제도 운영	 제안 포상 제도 운영
 선택적 복리후생제도 운영 (복지포인트 지급)	 생일자 지원 및 가정의 날 운영	 휴양소 지원	 특허 지원 제도 운영

※ 채용담당자 : 김승중 부장/ 070-5194-7724/ HR@gaonchips.com

사업분야	반도체 제조업 / 기술서비스업	
회사정보	회사설립년도	2017 년
	회사주소	대전광역시 유성구 유성대로 773
	직원수	21 명
직원프로필	왕성호 : CEO (공학박사, KAIST 전기 및 전자공학과) 김근회 : CTO (공학박사, 연세대학교 전자공학과) 제민규 : 기술고문 (공학박사, KAIST 전기 및 전자공학과, 현 KAIST 교수)	
'21 ~ '22 년 매출액	3 억(2020), 3 억 4 천(2021), 7 억 5 천(2022, 예상 매출액)	

Company Overview

주요 서비스 소개	네메시스는 Fabless Company 로서 Intelligent Signal Processing SoC 를 주 제품으로 합니다. 기존의 센서 신호처리 칩에 Universal sensing, Cognitive sensing 및 neuromorphic computing 을 이용하여 스마트 센싱이 가능하며, 주 응용분야로는 웨어러블, 바이오, 헬스케어 등이며, 산업, 가전 등으로 확장이 가능합니다.
시장분석	- 네메시스의 주력 제품은 바이오 진단에 사용되는 반도체 칩이며, 바이오 신호 모니터링 (바이오 마커 및 바이탈 사인) 시장은 빠른 속도로 성장하고 있으며 2026 년 US\$ 78.1 billion 의 규모가 예상됨 - 바이오 모니터링 시장은 진단, 약물전달 등이 있으며, 이중 에서 60%의 시장 점유율을 가지는 진단 시장에 집중함
비즈니스모델 (기업수익구조)	 개발비 제품 매출 대금 로열티 계약회사 의료기기 제조사 헬스케어 서비스 사 사용자 지능형 바이오 신호처리 솔루션 디지털 헬스케어 디바이스

경쟁사 및 경쟁력 (국내외 유사사업을 영위하는 경쟁사 분석)	항목	네메시스 솔루션	타 칩 공급사 솔루션
	제품	SoC + 알고리즘 + 센서 + 서비스	SoC
	기계학습 지원	Tiny ML 기반의 알고리즘 지원	없음
	아날로그 기술	고유의 Universal Interface 기술	높은 bit 의 ADC 지원
	전류소모	알고리즘을 이용한 전류소모의 최적화	높은 bit ADC 및 고성능 디지털 필터로 전류소모 큼
	지원 서비스	Customize, Private Labeling	Customize 지원 안 함
	공급	고객 맞춤형 딜리버리 지원	공급 지연 및 일방적 단종 통보 우려 있음
	고객 기술지원	소수의 전략 고객 위주 맞춤형 기술지원	다수 고객 대상 일괄 기술지원
향후 사업방향 및 비즈니스 이슈	• 초기 국내 시장에서 검증 후 글로벌 시장 진출 계획 • 혈당, 코티솔, 암진단 등 다양한 바이오 마커 및 바이탈사인 모니터링 시장으로 확대		
특허 보유현황 (기술 허들)	반도체 및 바이오 센서 (연속 혈당측정)에 필요한 기술 등 10 건의 특허 등록과 8 건의 특허 출원 (1 건의 해외 출원포함), 총 18 건의 특허		

※ 채용담당자 : 김근희 부사장/ 070-4837-5778/ luke.kim@nemesis.kr
고덕훈 차장/ 031-698-4090/ dh.ko@nemesis.kr



네오와인

www.neowine.com

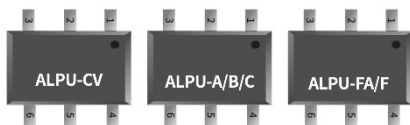


“기술을 통하여 안전한 세계를”

(The more secure world)

최근 정보화 세계가 도래하면서 각종 보안사고가 발생하고 있다. 네오와인은 이러한 정보화 세상에서 안전을 지켜가는 회사가 되고자 한다. 사람을 사랑하고 배려하며 더 안전한 세상을 반도체와 소프트웨어를 통해 구현하는 일에 네오와인이 함께하고 있다.

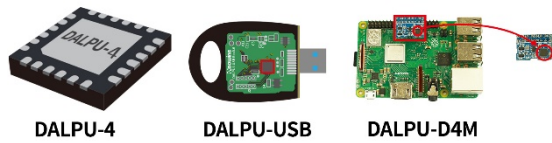
복제방지 반도체 (ALPU 시리즈) / 차량용 반도체 (ALPU-CV)



네오와인은 복제방지 반도체인 ALPU-4 를 2004년 첫 번째로 출시하였다. ALPU 시리즈는 ALPU-4, ALPU-5, ALPU-MP, ALPU-C, ALPU-CV, GEN-FA 등 많은 제품을 출시해 하였고, 전 세계 2000여개 회사에 1.2억 개를 판매하는 실적을 올렸다.

특히 차량용 보안 반도체인 ALPU-CV는 네오와인의 품질 및 안정성 기술력으로 -40 ~ + 125 사이의 가혹 조건 온도에서 동작 가능 하도록 설계되어 AEC Q100 1등급 인증되었다. 이로 인하여 ALPU-CV는 30여개 회사의 각종 자동차용 보안에 양산 적용되고 2022년 현재 100 만개의 자동차용 반도체를 판매가 예측된다.

암호화 반도체 (DALPU 시리즈)

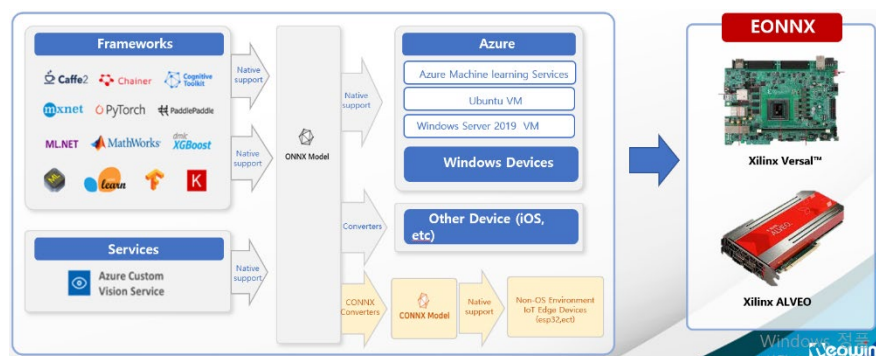


DALPU 시리즈는 해쉬암호 SHA256, 대칭 암호기술인 AES-256 및 ARIA-256, 비대칭 암호기술인 ECC-256과 TRNG, PUF 기능을 구현하였다. DALPU-4 는 SoC에서 동작하는 KCMVP 펌웨어 인증을 획득하여 여러 공공 프로젝트에 적용 중이다.

동형암호기술개발

최근에는 과학기술정보통신부와 산업기술통상자원부의 지원을 받아 4세대 암호기술인 동형암호 인코딩 및 디코딩 그리고 연산을 반도체에서 가속 시키는 기술을 개발 중이다.

인공지능 NPU 개발



네오와인은 인공지능 하드웨어 연산가속기 NPU를 FPGA 및 SoC로 구현하고 있다

여기에 필요한 하드웨어 Effective convolution engine을 비롯한 각종 AI 연산자를 RTL Level로 구현하고 이를 SoC화 하고 있으며 여기에 필요한 컴파일러 및 소프트웨어를 개발 하고 있다.

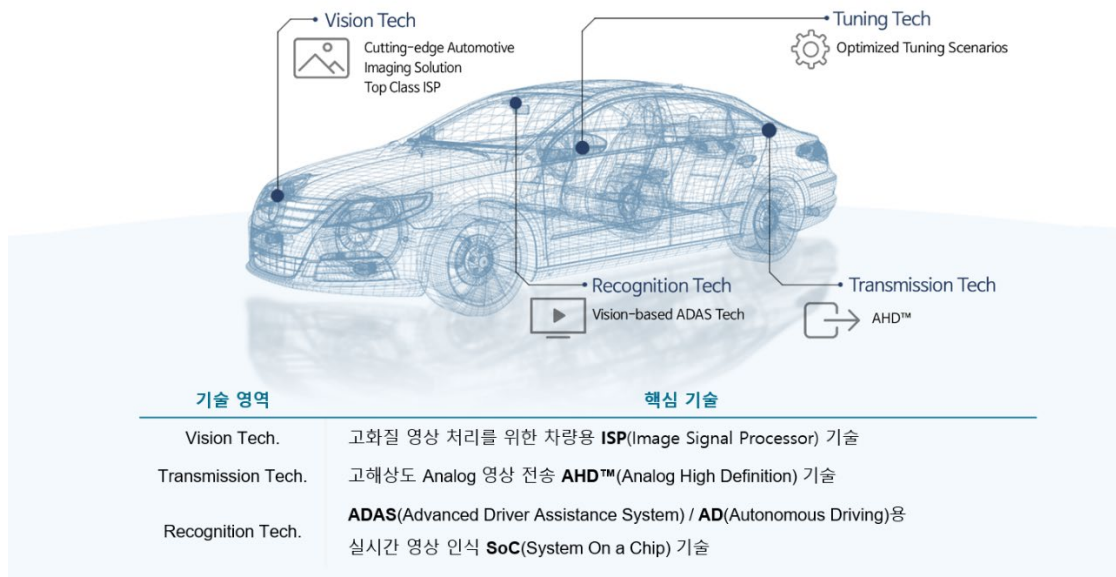
※ 채용담당자 : 김재학 부장/ 031-620-1266/ angeldream@neowine.com

차량용 고화질 영상신호 처리 반도체를 설계·개발하는 팹리스 기업

넥스트칩은 1997년에 설립된 기업으로 지난 2019년 1월 2일자로 (주)넥스트칩이 현재의 (주)넥스트칩과 (주)앤씨앤으로 물적 분할되었으며, 기존 넥스트칩(NEXTCHIP)을 사명으로 Automotive 사업을 이어가고 있는 중입니다. 올해 7월 1일에는 코스닥에 상장하였습니다.

고화질 영상을 안정적으로 구현할 수 있는 당사의 기술력을 바탕으로 2011년부터 차량용 반도체 개발에 나섰으며 장기간에 걸친 노력 끝에 2019년부터 양산을 시작했습니다. 매출액은 2019년 37억원, 2020년 104억원, 2021년 245억원으로 꾸준히 상승 중이며, 올해는 300억원의 매출을 올릴 것으로 기대하고 있습니다.

회사 보유 핵심기술 : 자동차용 지능형 고화질 영상처리 및 인식 시스템 반도체 기술



01. 전장용 ISP (IMAGE SIGNAL PROCESSOR)

자체 보유한 ISP Core 를 활용하여 Automotive Application(후방/전방카메라, E-mirror, CMS 등)에 맞는 기능 및 인터페이스 등을 다양화하여 제품 라인업을 구축 중이며, 현재 QHD(5M)까지 처리 가능한 Automotive ISP 를 시장에 출시하였고 UHD(8M)급 제품은 2022 년 4Q 출시 예정

02. ADAS((Advanced Driver Assistant System) SoC

카메라 모듈 내에 탑재하여 실시간으로 주변 객체를 검출하여 ECU에 전달하는 Edge Processor 역할을 수행하는 CV 기반의 APACHE4와 CNN 기반의 APACHE5가 양산 중. 특히 1.6TOPS 급 딥러닝 프로세서가 내장된 APACHE5는 네트워크 변경을 통해 전후방 AEB, BSD, DMS 등 다양한 어플리케이션을 지원할 수 있다는 특징점 보유. 자율주행이나 자동발렛주차를 위한 카메라 및 초음파, Lidar 센서 등 멀티센서 데이터를 Fusion 하여 처리할 수 있는 APACHE6도 개발 중으로 향후 순차적으로 ADAS SoC의 라인업을 확대할 예정

03. AHD™(Analog High Definition)

독자적으로 개발한 고해상도 영상 전송 기술로 기존 LVDS 솔루션의 전송 거리 제약 및 비용(칩셋, 케이블, 커넥터 등) 문제를 해결하여 특히 상용차와 같은 차체가 긴 차량에 적합한 솔루션. AHD™는 넥스트칩의 핵심 기술인 ISP와 전송 기술(TX)의 통합으로 Compact 하며, 최장 300m까지 전송 가능. 수신 기술(RX)의 조합으로 합리적인 시스템 구성이 가능하며 세계 최초로 자동차 양산 모델에 채용

신뢰성 높은 기술력을 바탕으로 2025년까지 1,000억 수출 달성 목표

전장 시장은 높은 신뢰성을 요구합니다.

이에 넥스트칩에서는 안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 차량용 반도체 개발 프로세스인 **ISO26262, A-SPICE, CMMI 2.0 프로세스 인증**을 취득하여 해당 프로세스에 따라 제품을 개발하고 있으며, **AEC-Q100 Gr.2 수준의 신뢰성을 확보한** 제품을 양산하는 등 고객사의 요구사항을 충족시키고 있습니다. 이러한 기술력과 성장 가능성을 인정받아 지난 2년여간 **총 402억원의 투자유치**에 성공하였으며, 지난 7월 1일자로 **코스닥 상장**까지 이뤄냈습니다. 당사의 Market Strategy에 따라 제품별 양산을 확대 중으로 2025년까지 10개 이상의 글로벌 협약사(Tier)를 대상으로 1,000억 수출 달성을 목표로 하고 있습니다.



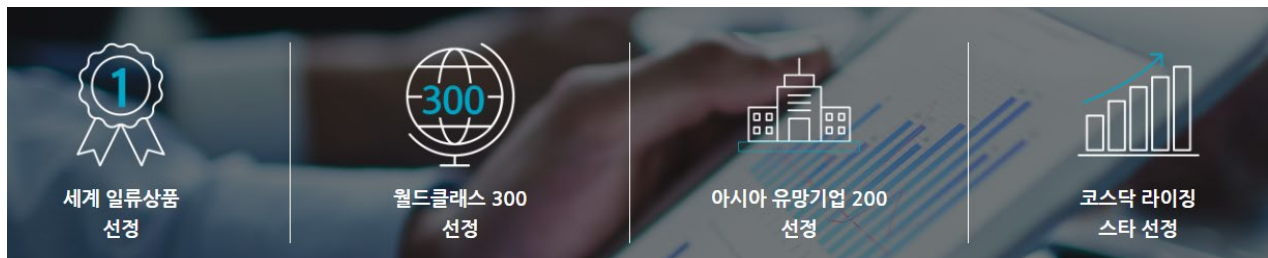
자사 제품 및 해외 차종 모듈 탑재 양산 사례

※ 채용담당자 : 김수민 선임 / 02-3460-4598 / ssumkim@nextchip.com

회사 개요

회 사 명 : (주)동운아나텍
 대표이사 : 김동철
 설 립 일 : 2006 년 7 월
 상 장 일 : 2015 년 KOSDAQ 상장
 임직원수 : 125 명 (2022 년 8 월)

주요사업 : AF/OIS, ToF, Haptic,
 Fingerprint Module,
 Bio/Health Care
 매 출 액 : 500 억 (2021 년)
 홈페이지 : dwanatech.com



회사 소개

세계를 향해 뻗어가는 기업, 동운아나텍

2006 년 설립된 팹리스 기업 동운아나텍은 시스템 반도체의 수많은 적용 분야 중 스마트폰 카메라용 AF Driver IC 를 주력으로 개발하고 있으며, 수년간 AF M/S 판매량 1 위를 유지하고 있습니다.

글로벌 경쟁력을 갖춘 AF Driver IC 이외 국내 최초로 개발된 OIS Controller IC, 하이테크 기술력을 담은 ToF Driver IC, 다양한 컨슈머 기기에 적용할 수 있는 Haptic Driver IC 등 동운아나텍의 기술력은 글로벌 시장에서 인정받고 있습니다.

또한 동운아나텍의 축적된 기술력을 통해 최근 지문인식, Healthcare 등 시스템 반도체를 활용한 다양한 시장 진입으로 지속가능한 기업의 미래를 준비하고 있습니다.

기회를 기다리는 것이 아닌 기회를 만들어 가는 곳,
 동운아나텍입니다.

연구소 소개

동운아나텍의 연구소 (R&D Center)는 새로운 제품을 개발하고 기존 제품을 개선하는 데 있어 일종의 두뇌역할을 담당하고 있으며, 주로 IC 설계와 검증 등의 혁신적인 업무를 수행하는 부서입니다.

연구소는 대부분 엔지니어로 구성되어 있으며, 아날로그 회로설계, 디지털 회로설계 및 레이아웃 설계 분야로 구성되어 있습니다.

Analog 회로설계는 AMP, ADC, DAC, PLL, BGR, LVDS, DCDC Converter 및 Driver 등을 설계하며, 고해상도, 저노이즈, 저전력을 위한 여러 설계 기술을 연구하고 적용합니다.

Digital 회로설계는 I2C 및 SPI 등과 같은 각종 interface 및 MCU core 와 BUS, Memory 등을 embedding 하고 control 하는 기능을 설계합니다.

Layout 은 설계된 DB 를 foundry 에서 생산할 수 있도록 physical 한 도면을 설계하는 업무로서 size 최적화, 높은 reliability 등을 얻을 수 있도록 도면을 설계합니다.

복리후생

 시차출퇴근제 8~10 시 출근, 5~7 시 퇴근.	 어버이날 효도비	 조식/중식/석식 지원
 생일/결혼기념일 선물 생일 축하금 결혼기념일 꽃다발+케이크	 기숙사 지원	 종합건강검진지원
 가정의 날 매월 4 째주 수요일 2 시간 조기퇴근	 자기 계발비 도서 구입비	 독감주사

※ 채용담당자 : 장재업 차장/ 02-3465-7921/ jang82up@dwanatech.com

『회사소개』

라닉스는 반도체 소프트웨어 융합기술을 바탕으로 최첨단의 비메모리 반도체 칩을 설계/개발하는 80명 규모의 강소기업입니다.

2003년 설립되어 자동차와 사물인터넷의 핵심 기술인 무선 통신과 보안용 반도체 및 S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 융합하여 사업화하는 혁신융합기술 기업입니다. 2019년 코스닥시장에 상장하였고, 21년에는 중국지사를 설립하여 해외 시장의 기회도 넓혀 나가고 있습니다.



자율주행자동차를 완성하기 위한 필수 요소 중 하나인 V2X(Vehicle to Everything) 통신 모뎀 기술을 국내 기업으로는 유일하게 개발하여 솔루션을 보유하고 있으며, IoT 산업의 발전을 위해 해결해야 하는 해킹 방어용 보안/인증 칩 솔루션을 선도적으로 개발 확보해 나가고 있습니다.

현재 자동차 전용 국내 표준 통신 프로토콜인 DSRC 모뎀은 2007년 상용화에 성공하여 하이패스 단말기에 통신 모뎀으로 장착되고 있으며, 현대기아자동차 및 벤츠, BMW 등에 장착되는 등 국내 Before Market의 90%를 점유하고 있습니다.

또한 레이더 기술을 이용한 CPD(Child Presence Detection)솔루션과, 개인화 응급 케어 서비스 제품(mPERS -mobile Personal Emergency Response System)을 개발하여 헬스케어 시장에도 진입하고 있으며, MCU와 보안칩 그리고 V2X 통신을 통해 자율주행 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

라닉스는 in-cabin 센서기술, 통신, 반도체, 보안 기술이 융합된 전장용 반도체 솔루션 회사로 성장해 나가고 있습니다.

주력제품/서비스

 ETC Modem SoC (MaaT)	 IoT Security	 V2X Platform, V2X Modem SoC	 mPERS
---	---	---	--

『연 혁』

- 2021 보안 암호칩(RS1211) KCMVP 인증 획득
중국법인 설립
- 2020 보안암호칩(RS2332) KCMVP 2 등급 최초 획득
- 2019 한국거래소 코스닥 상장
WAVE V2X 통신 솔루션 출시 (N-WAVE, 3 세대 ASIC 기반)
After Market 시장 진출
- 2018 제 20 차 중국고속도로 정보화기술 전시회 참가
암호 보안 컨트롤러 상용화 (RS2332)
하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-V)
- 2017 WAVE V2X 통신 솔루션 개발 (G-WAVE, 2 세대 ASIC 기반)
- 2016 중국 ETC용 DSRC SoC 개발(THoTH)
- 2015 하이패스용 DSRC SoC 상용화(MaaT IV)
WAVE Modem/MAC 2 차 시제품 개발(S-WAVE)
IoT 저전력, 경량화 보안칩 개발
- 2014 모바일 지불결제용 SD Controller 상용화 (Astroids II)
- 2013 휴대폰 배터리 인증칩상용화(RP4301)
- 2012 금융결제용 Micro SD Controller 상용화
- 2011 WAVE Modem/MAC 1 차 시제품 개발(E-WAVE)
- 2009 INNO-BIZ 기업 선정
- 2008 DVR 용 H.264 코덱 상용화
- 2007 하이패스용 DSRC SoC 상용화(MaaT I)
- 2005 기업부설연구소 설립
- 2004 DVB-S 용 CAM SoC 상용화
벤처기업 인증
- 2003 (주)라닉스 설립

『근무환경 및 복지』

• 근무 형태 및 환경

- 유연근무제도 : 07:00~10:00 자율출근
- 편안한 출퇴근길 : 지하철 7 호선 학동역 도보 5 분이내, 사옥내 주차공간 보유
- 쾌적한 업무환경 : 피트니스 센터, 샤워실, 수면실, 카페테리아(각종 음료 및 커피머신)

• 휴가 및 복지

- 연차휴가
(연차, 반차, 반반차 세부구분 사용가능)
- 회사 리조트 이용 가능

• 성장지원

- 원어민 영어회화 교육 운영
- 직무 관련 컨퍼런스 및 외부교육 참여지원
- 자체 기술세미나 수시 진행

- 채용담당자 : 이기훈 Pro / 02-584-5516(416)/ recruit@ranix.co.kr

회사개요

설립 시기	2009.10.13	직원 수	49 명
소재지	경기도 성남시 분당구 성남대로 779 번길 17		
핵심기술분야	마이크로디스플레이 솔루션	주요 제품	마이크로디스플레이

1) 메타버스 세상을 선도하는 세계 1 위 마이크로디스플레이 회사

2) 국내 유일의 증강현실 반도체/디스플레이 솔루션 상용화 기업

주요 서비스 및 제품 소개

1) 마이크로디스플레이 및 SoC

구 분	제품 대표 사진	제품 설명
마이크로 디스플레이 모듈		LCoS 및 Micro-OLED, Micro-LED 기술로 제작된 마이크로디스플레이 모듈, AR/VR/MR기기, Projector, HUD등의 핵심 부품
컨트롤러 SoC		입력영상에 대해 광학 왜곡 보정, Zero-MTP Latency등을 수행한 영상을 제어신호와 함께 마이크로디스플레이에 전달하는 칩

2) 적용 분야



증강현실 AR/MR Glasses & HMD
(Consumer & Industrial)



프로젝터/스마트TV



Automotive/전장
(AR-HUD / Lighting)



위상변조방식 광통신 스위치
SLM(spatial light modulator)/
WSS(wavelength selective switch)



Customization
(Panel/Backplane/ASIC)

3) 차별성 및 혁신성

- 공학 왜곡 보정을 위한 기술 보유
- 초저지연 솔루션(Zero-MTP Latency) 기술 보유
- 세계 최초, 최소 크기 픽셀 기술 보유

주요 제품소개 및 개발 진척도

- 1) LCoS(액정형 마이크로디스플레이) 양산 및 사업화
- 2) 자체 발광형인 Micro-OLED, Micro-LED로 사업 분야를 확대하고 있음



회사 소개 및 비전

라온텍은 시스템반도체 기술을 바탕으로 반도체 웨이퍼 위에 손톱만한 크기의 초소형/초고해상도 마이크로디스플레이 및 관련 SoC 반도체를 설계 제조 판매하는 메타버스 분야의 시스템반도체 팹리스 기업입니다. 라온텍의 제품은 전세계 증강현실 안경, 증강현실 HUD(헤드업디스플레이), 빔프로젝터, 광통신장비에 사용되어 마이크로디스플레이 시장을 선도하고 있습니다. 마이크로디스플레이는 반도체 기술과 디스플레이 기술이 융합되며, 최첨단 광학기술과 결합되어 안경같이 가벼운 스마트안경을 가능하게 합니다. 라온텍은 전세계로 제품을 수출하고 있는 국내 유일의 마이크로디스플레이 전문 기업으로 액정방식의 LCoS 제품은 대량 생산 납품하고 있으며, 차세대 Micro-OLED, Micro-LED로 연구개발을 이어가며 미래를 준비하고 있습니다.

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권	주요 수상 내역
2021.05 필드순차색상표시장치	2021.11 신제품(NEP)인증
2020.08 RAM 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치	2021.10 KES2021 혁신상 수상
2020.08 패널 타임 워프를 갖는 AR/VR/MR 시스템용 디스플레이 유닛	2020.11 대통령 표창(대표이사), 반도체 산업발전 유공자
2019.07 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치에 사용되는 인에이블 신호생성방법	2020.11 국가대표 혁신기업
2018.07 디지털 시그마-델타 변조기	2020.07 BIG3 기업
2017.09 화면 왜곡 보정이 가능한 디스플레이 장치 및 이를 이용한 화면 왜곡 보정 방법	2020.04 소재부품장비 전문기업
외 49건 등록 및 출원	2016.12 K-ICT 스마트 디바이스 우수상

※ 채용담당자 : 한성준 상무/ 031-786-4633/ Joey.han@RAON.io



(주) 램칩

www.ramschip.com

ram-sCHIP
F N A L O G I X E D I G N A L

“Wielding technology to design super-fast SERDES”

램칩은

고속 인터페이스 IP 에 특화된 전문성을 갖고 있는 반도체 설계 IP 기업입니다. 우리는 선을 타고 흐르는 데이터의 이동이 어느 표어처럼 보다 빠르게, 보다 멀리, 보다 안정적으로 가능하도록 하는 회로 기술을 개발하고 있습니다. 이를 위해서 진보된 설계 흐름을 함께 마련하여 보다 영리하게 문제를 해결하려고 합니다. 램칩은 경쟁력 있는 IP 를 공급하기 위해 최첨단의 아날로그 회로 설계 기법, 신뢰할 수 있는 디지털 로직 구현은 물론 안정적인 고속 전송을 위한 신호 처리 알고리즘과 최적화 문제를 풀기 위한 소프트웨어적 접근을 포함하는 폭넓은 연구 활동을 수행합니다.

2021 년에 세워진 램칩은

최고의 기술 회사를 목표로 풍부한 경력과 전문성을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

- ▷ 2021. 1 – 법인 설립
- ▷ 2021. 3 – 시스템 반도체 설계지원센터 입주
- ▷ 2021. 6 – 벤처 기업 인증
- ▷ 2021. 10 – 기업 부설 연구소 설립
- ▷ 2022. 1 – 삼성 파운드리 협력사 시스템 구축
- ▷ 2022. 2 – SEED 투자 유치
- ▷ 2022. 3 – BIG3 혁신분야 창업패키지 지원 사업 선정
- ▷ 2022. 4 – 시스템반도체 핵심 IP 개발 사업 주관기관 선정

현재, 램칩은

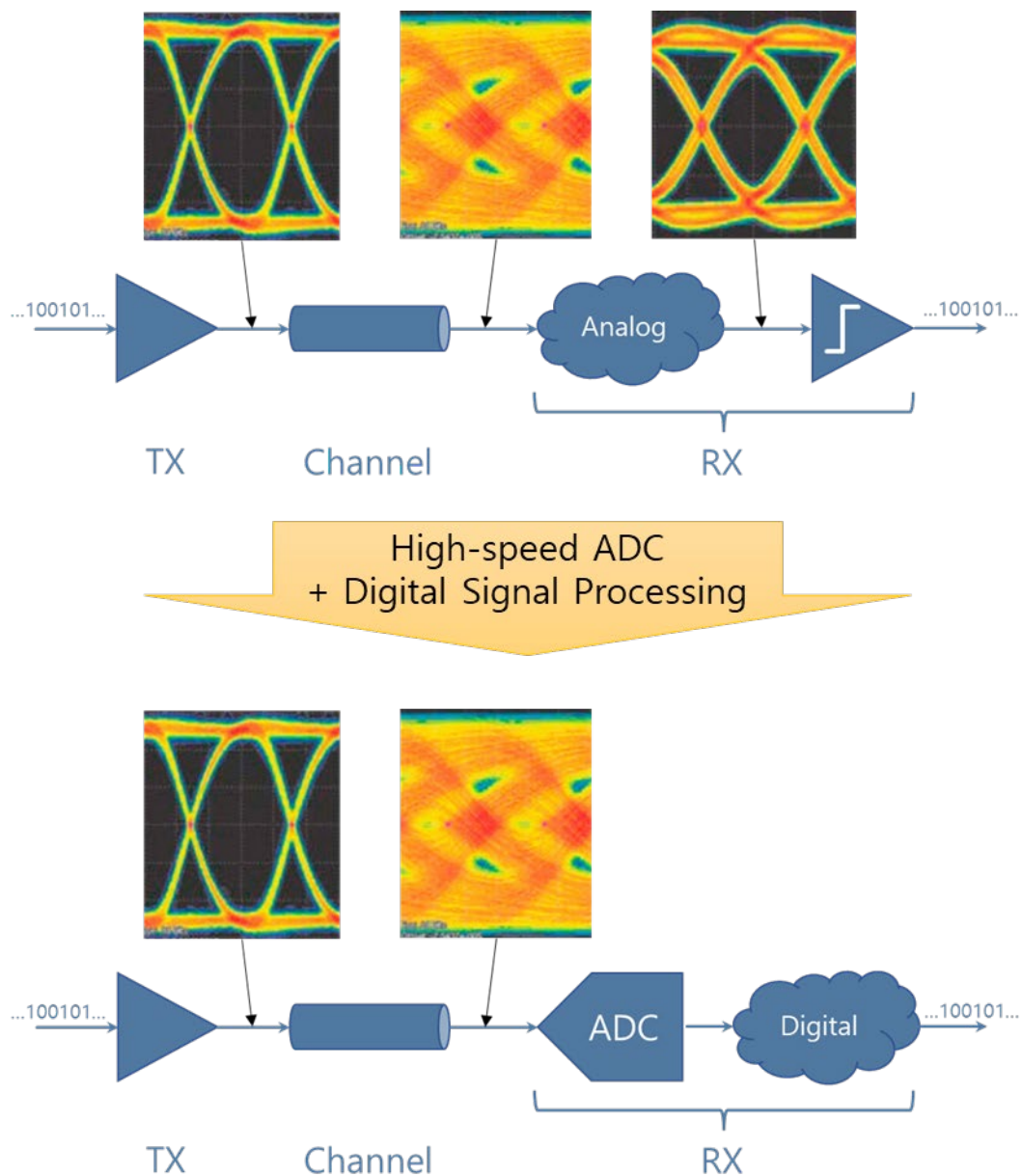
다가올 자율주행 기술과 날로 발전하는 지능형 운전자 보조 시스템(Advanced Driver Assistance System)에 필수적인 이미지 데이터 전송을 위한 고속 인터페이스 IP 를 준비합니다. 이와 관련된 국제 표준인 MIPI A-PHY 와 ASA MotionLink 에 대응하는 회로 기술을 확보하여 차량용 반도체 시장에 진출하려고 합니다.

또한, 삼성 파운드리와 Sublicensing 파트너사로 국내외 수요기업에게 5nm 이하부터 시작하는 초미세 FinFET 공정을 포함하여 다양한 공정 노드에서 MIPI D-PHY/C-PHY, ARM HSSTP IP 등의 SoC 용 IP 를 공급하는 사업 모델을 갖고 있습니다. 삼성 파운드리와 맺어진

긴밀한 협력 관계와 램쉽의 설계 기술이 더해져서, 스타트업으로서 기대할 수 있는 가장 빠른 성장 속도로 반도체 설계 업계에 자리 매김할 것입니다.

핵심 보유 기술은

채널을 통과하며 왜곡된 고속의 전송 신호를 복원하고, 타이밍을 추출하여 원래의 값으로 수신하는 회로 설계 기술입니다. 특히, 전통적으로 사용되는 아날로그 영역에서의 데이터 처리 기술은 물론, 최근 각광받고 있는 고속의 ADC(Analog-to-Digital Converter)와 DSP를 기반으로 하는 인터페이스 회로 기술을 보유하고 있습니다.



※ 채용담당자 : 임종혁 팀장/ 010-7232-7822/ jhlim@ramschip.com

소개

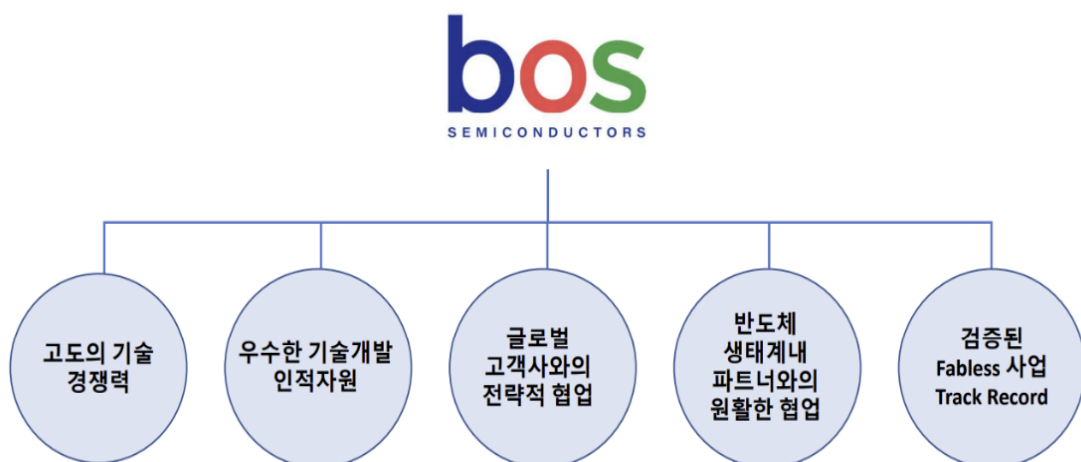
(주)보스반도체는 세계적인 수준의 자동차 반도체, 모바일 반도체 및 컨슈머 반도체 개발 역량을 보유한 인력들이 "Lead mobility innovation with System Semiconductors"라는 꿈을 가지고 창업한 자동차 반도체를 전문으로 개발하는 팹리스 기업입니다. 글로벌 탑플레이어들과 기술 경쟁을 할 수 있는 최고 수준의 팹리스 기업으로 성장하겠습니다.

History

- 2022 년 5 월 창업
- 2022 년 8 월 현대자동차로부터 Seed 투자 유치

보유 핵심기술

- 자동차 반도체에 필수적인 고성능 저전력 반도체 설계 기술 및 Safety 및 Reliability 기술, 인공지능 기술, 컴퓨터 중앙 처리 장치 및 그래픽스 기술, 디지털 시그널 처리 기술, 화상 처리 기술, 고속 신호 인터페이스 기술, DRAM 인터페이스 기술
- 반도체 하드웨어 및 임베디드 소프트웨어에 대한 풍부한 경험
- 자율주행 소프트웨어에 대한 깊은 이해



- 차량용 반도체 Safety, Reliability 등의 제한조건 경험

1 차 목표제품

- 보유한 핵심기술을 기반으로 고객사의 소프트웨어 및 하드웨어 요구사항에 최적화된 Custom SOC (e.g. 자율주행 시스템)



중장기 발전 전략

- OEM 과 전략적 협력을 통한 Automotive SOC 시장 진입
- 국내외 자율주행 및 모빌리티 스타트업과 협업
- 베트남 R&D 센터 설립 통한 기술개발 역량 확보
- ADAS·자율주행, Gateway, Mega-MCU(HPC), Infotainment 등 automotive SOC 전 영역 line-up
- Automotive 영역의 성공을 기반으로 Robot, UAM 영역까지 확장

※ 채용담당자 : 서경미/ 010-2276-9786/ msgyeongmi@bos-semi.com



브이에스아이(주)



www.vsitech.co.kr

당사는 송파구 문정법조타운 소재 벤처기업으로 우수한 연구인력이 전체의 70% 이상인 반도체 팹리스 기업입니다. 자율주행차용의 핵심 기술인 카메라 및 고속 센서 송수신 링크 기술을 개발하고 있으며, 이를 이용해 차량용 반도체를 설계/제작/판매하고 있습니다. 세계 최초로 16Gbps 급 카메라 링크 칩을 출시하였고, 국내/외 완성차 및 Tier1/2 기업들과 협력 개발을 통해 빠르게 성장하고 있는 기업입니다.

주요 연혁

연 월 일	내 용
2022.07	Series B 투자 완료
2022.06	세계 최초 16Gbps 급 차량용 고속 링크 반도체 샘플 출시
2022.04	반도체 기능 안전 인증(ISO26262) 계약 체결
2022.03	독일 BMW사에 차량용 고속링크 개발 솔루션 공급 계약
2021.11	세계 최초 16Gbps급 차량 고속 링크 반도체 개발 (Fab-In)
2021.10	ISO9001:2015 품질경영시스템 인증 획득완료
2021.05	Series A 투자 완료
2020.12	독일 보쉬사 차량용 이더넷 개발 솔루션 공급
2020.09	반도체 성장 펀드 1호 투자 유치
2020.05	산업자원부 차량용 고속 링크 개발 과제 선정
2020.04	차량용 반도체기업 Infineon과 차량용 이더넷 협력 MOU 체결
2019.09	실리콘 밸리 사무실 개소(Velonect)
2019.04	과기정통부 차세대 지능형 반도체 개발 기관 선정
2018.05	중소기업청 TIPS 프로그램 선정
2018.03	KITE 엔젤 투자 유치
2017.03	벤처인증, 기업부설연구소인증

사업 내용 및 기술력

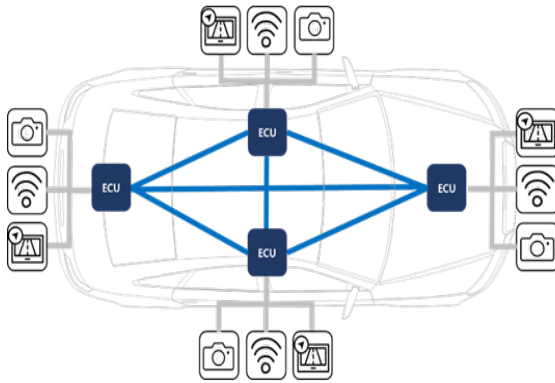
▶ 차량용 초고속 링크 개발

- 글로벌 완성차 기업인 BMW 를 주축으로 하는 ASA(Automotive SerDes Alliance) 기술을 기반으로 세계 최초의 16Gbps SerDes 제품 출시하여 다수의 완성차 및 Tier 1/2 기업과 협력하여 개발을 진행하고 있습니다.

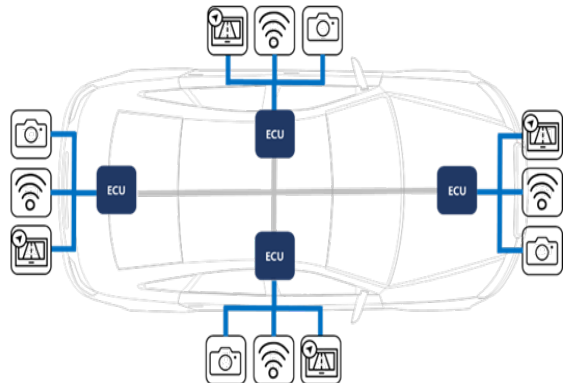
▶ 차량용 초고속 이더넷 트랜시버 개발

- IEEE 802.3cg 기반의 Ethernet 기술을 바탕으로 10BASE-T1S 샘플을 출시하였으며, 2.5G/5G/10G 초고속 Ethernet 제품을 개발중에 있습니다.

ECU간 고속 이더넷 트랜시버 기술



센서/디스플레이 고속 링크 기술



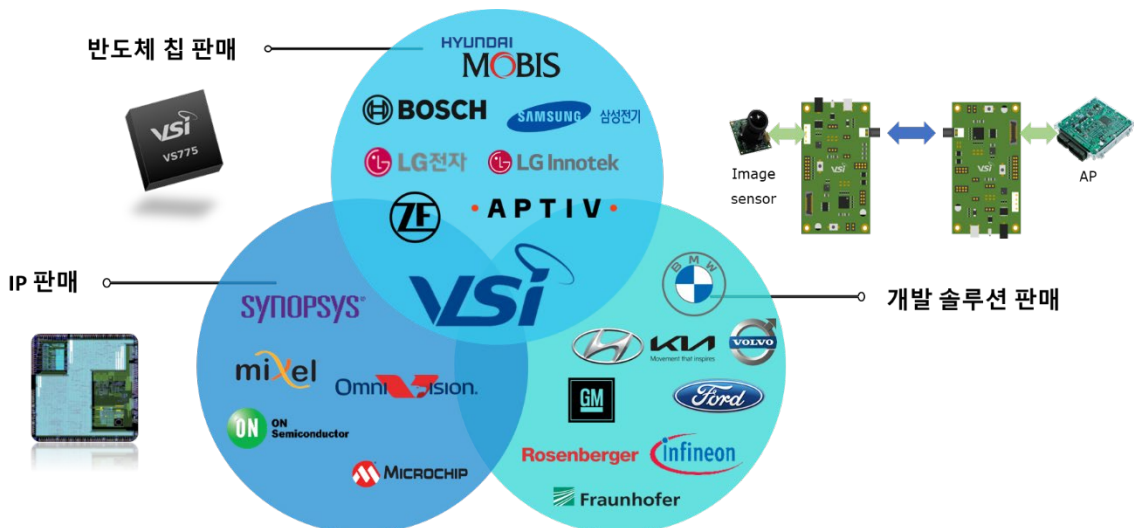
사업현황과 비전

▶ 국내/외 OEM 협력

- 현재 글로벌 완성차 기업인 B사와 제품 공급을 위한 프로젝트 진행중이며, 차량용 부품 기업인 국내 H사와 신제품 개발을 위해 협의 진행중입니다.

▶ OEM 검증을 통한 Tier1/2 수요 확장

- 세계 최초로 OEM의 reference 및 검증을 통한 ASA leader 자리를 확보 하고 있습니다



※ 채용담당자 : 김나현 팀장/ 02-3400-0139/ nhkim@vsitech.co.kr



“고객들이 원하는 SoC 를 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록 도와주는 플랫폼 제공”

회사 소개

세미파이브는 더욱 효율적으로 시스템 반도체를 설계할 수 있는 반도체 개발 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 오픈 테크놀로지와 독자적인 개발 방법론을 기반으로 반도체 개발에 필요한 비용과 시간을 단축함으로써, 앞으로 더욱 더 다양하고 혁신적인 시스템 반도체가 만들어질 수 있는 기반을 만들어 가고 있습니다.

사업 정보

세미파이브는 설립 3 년여만에 총 1700 여억원에 달하는 3 차례의 투자를 유치하며 인력과 사업 규모면에서 빠르게 성장하고 있습니다. 삼성전자 파운드리 DSP 인 세솔반도체와 하나텍을 인수하며 인력 확충 및 대규모 성장을 하였고, 미국 IP 회사인 Analog Bits 를 인수하며 사업 ecosystem 을 공고히 하였습니다. 2022 년에는 삼성전자 파운드리 DSP 지위를 득하며 삼성전자와 밀접한 협력 관계를 구축하였으며, 국내외 대기업들과 파트너십 체결 및 개발 계약을 체결하며 입지를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 미국, 인도, 베트남 등 해외에 연구소 및 영업지사를 운영하며 적극적으로 글로벌 고객 및 인력을 확보하고 있습니다. 당사 플랫폼을 통해 개발되는 첫 제품은 2021 하반기 중 성공적으로 출시하였고, 2022 하반기 중 첫 양산에 돌입할 예정입니다.

회사 제품 설명

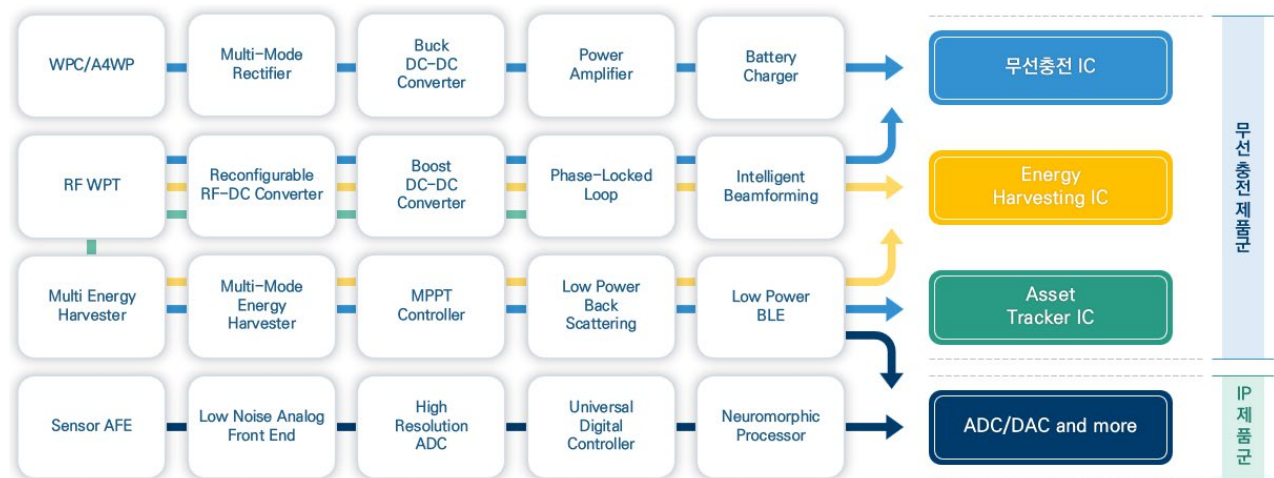
세미파이브는 Domain-specific SoC Architecture 를 통해 특정 응용처에 최적화된 Template 을 구현하고 재사용률을 극대화 하여 고객들이 원하는 SoC 를 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록 도와주는 플랫폼을 제공합니다.

핵심 보유기술 설명

기존 반도체 개발 방식은 IP 소싱부터 시작하여, POC(proof of concept), 검증, 설계, 프로토타입 제작까지 무수히 많은 프로세스를 직접 진행하며 최소 수 십억 원의 비용과 1~2 년의 개발 기간이 필요하지만, 세미파이브 디자인 플랫폼의 경우 이 프로세스의 상당 부분을 자동화하고, 다양한 분야에 재사용이 가능한 최적화 및 검증이 완료된 Template 을 기반으로 반도체 개발에 필요한 비용과 시간을 대폭 줄여줄 수 있어 더 많은 반도체 개발을 유도할 수 있습니다. 따라서, 고객들은 당사 응용처별 플랫폼에 자신들이 보유한 핵심 IP 와 Software 만 탑재하면 기존 방식 대비 훨씬 빠르고 쉽게 SoC 를 확보할 수 있게 됩니다. 현재는 아래와 같이 AI Inference 플랫폼과 AIoT 플랫폼을 개발하여 상용화 프로젝트를 완료 및 진행 중이며, AI Inference 플랫폼을 재사용하여 기간과 비용을 대폭 단축한 상용화 프로젝트 또한 2022 년 말 완료될 예정입니다. 또한, HPC 향 5nm 플랫폼을 이용한 상용화 프로젝트도 개발 진행 중이며, 향후 보다 더 많은 응용처향으로 플랫폼 포트폴리오를 확장시켜 나갈 것입니다.

※ 채용담당자 : 송정진/ 010-8290-1490/ Jeongjin.song@semifive.com

스카이칩스는 성균관대 IC lab 기반의 연구실 창업회사로, 10 여년간의 연구 및 기업체/국책 과제를 통해 개발한 많은 IP 를 바탕으로 2019 년에 창립되었습니다. 2021 년까지는 기업체 과제/국책과제를 주요하게 수행했으며, 그 동안 축적된 IP 를 기반으로 자체 제품 출시를 위해 개발을 진행하고 있습니다. 2020 년에 초기창업패키지 프로그램을 최우수로 마쳤고, 현재는 TIPS 에 선정되어 과제를 진행하고 있습니다.



스카이칩스는 AI 를 활용한 근거리·원거리 무선충전기술을 개발하는 팹리스 기업입니다. 무선 전력 전송 기술을 연구하는 팹리스 기업은 해외에도 많이 있으나 여기에 뉴로모픽 (Neuromorphic) AI 기술을 결합한 건 스카이칩스가 세계 최초입니다.

현 시점에는 접촉해야만 충전 가능한 무선충전 기술이 상용화되어 있지만 스카이칩스가 개발하고 있는 제품은 접촉 비접촉 상관없이 AI 가 스스로 파악해 멀리 있는 전자제품에도 무선주파수를 통해 전력을 전송해 줄 수 있는 시스템입니다.

근거리·원거리를 동시에 지원하는 무선충전기술 개발에 핵심이 되는 IP 들의 개발이 진척되어 현재 파운드리를 통해 제작 중에 있으며, 이에 대한 성능 검증 후 2023 년도에 본격적으로 양산에 돌입할 준비를 진행하고 있습니다.

이와 더불어 스카이칩스는 국내 굴지의 기업으로부터 자산/물류 관리에 사용되는 IC 에 대한 개발 의뢰를 받아 성공적으로 개발 진행중에 있으며, 고객사의 물량 예측에 기반하여 2023 년 초부터 많은 물량을 공급할 계획을 가지고 있습니다. 이 제품은 고객사의 제품 아이디어와 스카이칩스의 기술력을 합쳐 기획되었으며, 기존 제품의 한계로 인해 시장확대가 되고 있지 못한 자산/물류/재고 관리 시장에 획기적인 솔루션이 될 것입니다.

그리고 무선충전 및 관련 기술력을 인정 받아 series A 투자를 2022 년 상반기에 성공리에 마무리했으며, 또한 상장주관사로 삼성증권과 계약을 맺고 2024 년을 목표로 상장 준비에 들어갔습니다. 또한 2022 년 8 월에 삼성전자와 중소벤처기업부가 주관한 팹리스 챌린지 대회에 선정되었습니다.

신문기사에 실렸던 스카이칩스 이강윤 대표이사의 인터뷰입니다.

“하나의 전공에만 국한되지 않고 넓은 시야로 세상을 바라볼 수 있다는 것이 스카이칩스의 가장 큰 장점이라고 생각합니다. 때문에 스카이칩스 구성원들 또한 주체적이고 능동적으로 연구를 하면서 자신의 역량을 키워 나가고 있고요. 저 또한 연구와 사업을 병행하면서 남들보다 한발 더 앞서 나가는 연구를 하려고 노력하고 있습니다. 때로는 도전에 실패하더라도 다시 보완하여 도전할 수 있다는 점이 산학을 아우르는 스카이칩스의 장점이라고 생각합니다. 기업은 어찌됐던 이익을 추구해야 하기 때문에 실패 이후에는 다른 사업을 모색해야 하지만 스카이칩스에서는 이익을 낼 수 있는 안정된 제품군 개발은 물론, 실험적이고 도전적인 연구들도 함께 수행하고 있습니다. 시스템 반도체 분야에 대해 도전적이고 창의적인 인재들이 스카이칩스로 모였으면 하는 바람입니다.”



※ 채용담당자 : 경영혁신본부 최선영(catchdora@skaichips.co.kr) 031-291-0416

회사명	(주)실리콘아트	창업년월	2010년 4월
주요제품	GPU IP (2D/3D 그래픽과 인공지능 프로세싱을 처리하는 핵심 반도체 로직)	대표이사	윤형민 박사(전 삼성종합기술원)
본점주소	서울시 강남구 테헤란로33길 13-3, 9층	임직원수	34명
실리콘아트 평가 (검증 및 Awards)	① 주요 수상 - CIO OUTLOOK 선정 Top10 HPC Solution Providers (2019) - Silicon 60 Selected in EE Times Silicon 60: Hot Startups to Watch (2014, 2015) - 대한민국기술대상 산업통상자원부장관상 (2013) - NET 선정 Awarded New Excellence Technology by Korea Government(2012) ② 국제 학술 권위지 - HOT CHIPS: Presented RayChip® Architecture (2014) - SIGGRAPH: Presented RayCore® architecture (2014) ③ 해외 저명 언론 - EE Times (2014): "astounding (경악스러운) and earth-shaking (세상을 놀라게 하는)" - JPR TECH WATCH (2014): "disruptive technology", "We think these guys are really going to make a difference. I suspect they will be acquired in less than five years." ④ Intel社의 2년여에 거친 기술 평가 - Intel社 FPGA Gold Member Partnership 획득 ⑤ 2019년 세계 10대 하이퍼퍼먼스 솔루션 컴퓨팅 기업 선정 - 美 APAC CIO Outlook 선정 2019 세계 TOP 10 HPC Solution Providers 선정		
기존 기술 한계	① NVIDIA 및 INTEL, Imagination Technology 등의 제품 성능 한계 봉착 - CMOS 반도체 공정 발전의 한계 (현재 7nm 상용화, 3nm 이론상 한계) - S/W 처리 방식의 GPU 면적의 한계 (NVIDIA 280억개 트랜지스터 사용, 전력소모 350W) ※ Full HD 화질에서 실리콘아트 : 1.2억개 트랜지스터 사용(면적1/233), 전력소모 1W(1/350) ② 현 GPU 한계로 인한 VR 게임에서 멀미현상(Motion Sickness)의 심각한 문제 봉착 - 변화가 심한 Framerate 및 낮은 그래픽 퀄리티 - Oculus VR & Playstation VR - 13세 이하 사용 제한		
실리콘아트 핵심기술 및 제품	① MIMD Architecture에 기반한 차세대 그래픽 처리 (Ray-Tracing) GPU - 일정하고 높은 Framerate 제공 및 높은 그래픽 퀄리티 제공으로 VR 멀미현상 최소화 - 고성능 및 초저전력 GPU로서 PC/서버용 그래픽 카드부터 스마트폰 AP까지 적용 ② 최고 성능을 제공하는 MIMD Architecture에 기반한 AI Processor 개발 예정		

	- 저전력의 높은 인공지능 처리 성능 제공으로, 스마트폰을 비롯한 다양한 기기에 적용 - 인공지능 서버 탑재 시 전력 소모 절감 및 필요 서버 수 감소
핵심 특허	핵심 특허 : 국내 및 해외 총 23개의 특허 등록 (KR, US, JP) - MIMD (Multiple Instructions, Multiple Data) Architecture ("Core Patent") - Parallelized Unified T&I Unit ("Core Patent") - RayTree®: KD-tree Acceleration H/W Architecture for Dynamic scene ("Core Patent")
주요 제품 - 메타버스 최적화	차세대 플랫폼인 메타버스 클라우드 환경에서 저전력으로 현실과 같은 그래픽스를 제공할 목적으로 제품 포트폴리오 구성 및 프로모션. ① Ray Tracing / Path Tracing GPU IP (Raycore MC): 메타버스의 가상세계에서 현실감과 몰입도를 최대화하여 실감형 3D 그래픽스 구현, 제공 ② AI Acceleration Processor IP (RAIV) – AI 가속용 프로세싱. 메타버스에서 구현되는 그래픽스 이미지를 Denoising을 통해 품질 향상 ③ Metaverse GPU Chip (2023년 예정): 유저의 시청각 효과를 레이 트레이싱 기술로 구현하여, 메타버스(가상세계)에서 마치 현실과 같은 실감형 그래픽스와 사운드를 경험하도록 구현
실리콘아트스 기술 확장성 (시장 확대)	현재 실리콘아트스만의 차세대 그래픽 GPU 기술 보유 - 현재 VR 시장의 멀미/어지럼증(Motion Sickness) 및 낮은 그래픽 퀄리티 문제 해결의 유일한 솔루션이자 모바일 디바이스(폰, 태블릿, 노트북등)에 최적화된 초저전력 기술 - 높은 성능을 제공하는 독자적 MIMD Architecture 기반으로 AI Processor 등 인공지능의 주요 기술로 성장 가능
게임 및 UI에서 실시간 실감 그래픽 구현	  

※ 채용담당자 : 유재신 대리/ 02-470-2829/ jsyu@siliconarts.co.kr

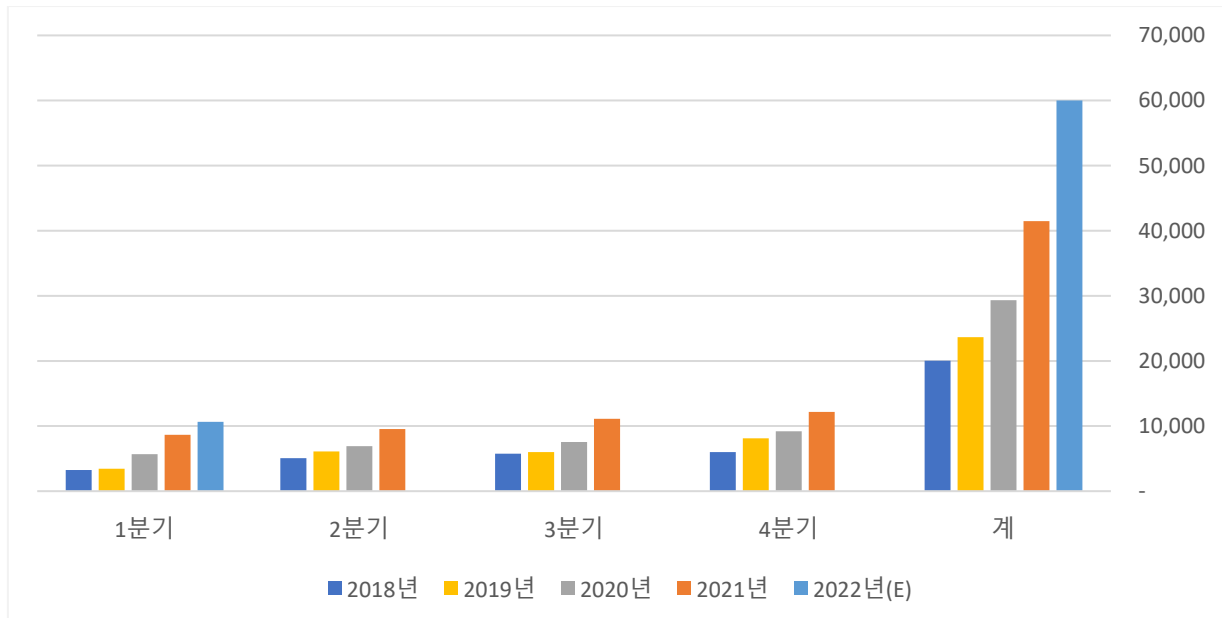
“18 년간 3ALogics 가 걸어온 길이 국내 NFC SoC 산업의 발자취”

- 국내 최초 NFC 리더 칩 부품 국산화 성공(2006 년)
- 국내 최초 NFC Dynamic 태그 칩 부품 국산화 성공(2014 년)
- 국내 최초 Automotive 용 NFC 칩 국산화 성공(2018 년)
- NFC 무선충전칩, Healthcare 용 sensor 내장 IoT 칩 개발(2022 년)
- 글로벌 NFC/RFID 및 IoT 시스템 IC 팹리스 기업으로 도약, 2022 년 매출 600 억원 목표

설립기 (2004 ~ 2006) 설립 및 RFID SoC 시장 진출	- 2004.04 회사 설립 - 2006.06 국내 최초 NFC 리더 칩 국산화 성공 - 2006.11 정보통신 중소기업 발전 유공 정보통신부장관상 수상
시장 초기 (2007 ~ 2011) RFID 리더 칩 양산 및 HF 태그 칩 개발	- 2007.08 Red Herring Asia 100 선정 (아시아 100대 기술기업) - 2007.10 경기 우수 중소.벤처기업 수상 – 경기도지사상 - 2009.06 중소기업청 '기술창업 선도기업' 선정 - 2011.04 경기 인터넷무역 프런티어기업 선정
성장기 (2012 ~ 2017) NFC 리더 칩 양산, NFC 태그 개발	- 2014.06 NFC Dynamic 태그 칩 국산화 성공 - 2014.12 제2회 두뇌역량우수기업(K-Brain) 선정 - 2015.02 IP스타기업 선정 - 2015.07 한국산업기술진흥원 프렌드 컴퍼니 지정 - 2016.11 기술평가 우수기업 인증 (NICE 평가정보 / T-3등급) - 2017.09 경기도 우수 중소기업 선정
도약기 (2018 ~ 현재) IoT/NFC 칩 Full line-up	- 2018.08 Automotive용 NFC 칩 국산화 성공 - 2019.08 최우수 벤처기업 선정(R&D,지속성장) - 2019.09 소재부품전문기업 선정 - 2020.02 BIG3분야 전문기업 선정(시스템반도체 부문) - 2020.06 판교 제2테크노밸리 사옥 기공(22년 10월 완공) - 2020.08 최우수 벤처기업 선정(R&D,지속성장) - 2020.11 소부장 강소기업 100 선정 - 2021.05 혁신기업 국가대표 1,000 선정 - 2022.10 Healthcare 용 sensor 내장 IoT 칩 개발 - 2022.12 판교 제 2 테크노밸리 반도체 클러스터 사옥 입주 - 2023. KOSDAQ 상장 예정

3A 로직스 최근 4 개년간 매출 및 증가율

- 지난 4 개년간 분기별 YoY 기준 모든 분기 빠짐없이 매년 상승 중
- 매출의 계절적 요인이 있으며 매년 연말로 갈수록 매출이 증가함
- YoY 분기별 25%~35%의 매출 성장 기록 중
- 연평균 20%~40%의 매출 성장 기록 중



복리후생



- 스톡옵션부여/2023 년 KOSDAQ 상장
- 핵심인재 법인 차량 제공
- 야근식대 지원
- 자기개발비 지원
- 10 년, 15 년, 20 년 근속 포상
(300 만원 여행상품권, 황금 열쇠, 포상휴가)
- 연말 인센티브/생일선물
- 야간교통, 주차비 지원
- 우수사원 포상
- 명절, 여름휴가 상여금
- 자율 복장
- 임직원용 휴양시설 제공
- 청년내일 채용공제
- 제 2 판교테크노밸리 반도체 클러스터 사옥입주

※ 채용담당자 : 강준구 이사/ 031-715-7117/ jgkang@3alogics.com

기업소개	아이닉스는 차별화된 영상화질을 출력하는 영상신호처리(ISP: Image Signal Processor) 반도체와 함께 지능형 영상처리를 수행하는 보안용 네트워크 카메라의 핵심반도체들에 대한 독자 기술을 보유하고 개발 판매하는 20년 업력의 대표적인 Fabless 회사이다.
주력분야	- Security, Pro-Video, Factory Automation, Automotive 산업용 SoC - ASIC, FPGA, SoC, Board Application 등 다양한 형태의 기술 제공
기업리뷰	2021년 국내에서 유일하게 CCTV용 지능형 IP네트워크, 차량용 영상기록장치(블랙박스)용 핵심SoC를 상용화하는 등 업계에서 최고 기술력을 인정받고 있고, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등의 국책 과제 다수를 주관기관으로서 수행하고 있으며 2015년 이후 현재까지 청년친화 강소기업으로서 인증을 받고 있습니다. 선택적근로시간제를 채택하여 직원 개개인이 본인의 업무시간을 스스로 운용할 수 있고, 수평적인 조직문화속에서 휴가와 퇴근 등이 자유롭고 성과와 역량에 근거한 연봉제도를 운영하고 있으며 뛰어난 업무역량을 보유한 직원을 대상으로 조기승진제도 시행하고 있습니다. 공학박사이며เจน틀한 성품의 소유자인 대표이사의 영향으로 연구원을 중시하고 존중하는 연구원 친화적인 분위기가 느껴지는 회사입니다.
기업대표이미지	현재 42개의 지식 재산권 보유

기타	• Work & Life Balance를 중시하는 문화. • 사내대출제도, 기숙사 제공, 학위취득 지원, 자기개발비 지원, 의료비 지원, 직원 단체상해보험 가입, 임직원용 휴양시설 제공, 성과보상 및 스톡옵션 제도, 10년 근속포상 및 특별휴가 제공, 생일 휴가 및 선물 등 다양한 복리후생 제도 운영 중. • 편리한 회사위치: 분당선 망포역 1번 출구 앞 (초역세권)
----	--

사내 복리후생 제도

건강관리	생활안정	개인의 성장	여가생활	즐거운 일터
 건강검진 지원 (더월병원,강북삼성병원)	 자녀양육 지원	 특허장려금	 휴양시설 제공 (대명리조트)	 스낵바 제공 식대 지급
 의료비 지원	 사내대출제도	 자기개발비 지원	 사내 체육시설	 장기근속자 선물 및 특별휴가
 직원 단체 상해 보험	 경조사 지원	 회사 장학생 지원 (회사 장학생 선발/학위취득 지원)	 사내 도서관	 명절/생일 선물 및 생일반차 지급
	 기숙사/사택 지원		 영화관람권 제공	 휴가비 지원

< 아이닉스의 역대 보유기술 >



No.1 AI SoC Solution Provider



Analog-Digital-Power in a SingleSilicon™ with valued Software solution

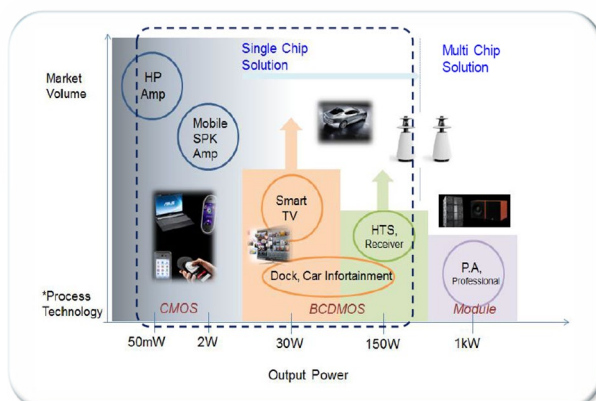
- Business Field : System Semiconductor
- Main Product : Audio/Power Semiconductor

Info.

Official Name	Iron Device Corporation
Established in	May 7, 2008
Founder/CEO	Ki-Tae Park
Address	402, 73 Garosu-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Employee	23
Main Product	Focusing on Digital/Power-Mixed SoC
Revenue	4,402M KRW (2021) / 2,380M KRW (2020)

Unified Audio Solution Provider for Smart Devices – a Fabless Semiconductor Company

- Driving from low power earphones to powerful loudspeakers
- High-fidelity data conversion and signal processing
- Using Bipolar-CMOS-DMOS Process/Circuit Technology
- Established in 2008
 - Found by the team from Samsung System-LSI
 - Has been designed high-end audio chipsets for [Bang & Olufsen] ICEpower since 2004
 - Mass production history – shipped over 200Mpcs
 - Now, in *Silicon Mitus* Family
- A mixed-signal semiconductor company, providing leading-edge digital/analog/power-mixed single silicon device solution.
 - In-house high-performance Audio IP Portfolio
 - Not only Rx (Playback) but also Tx (Record) Solution



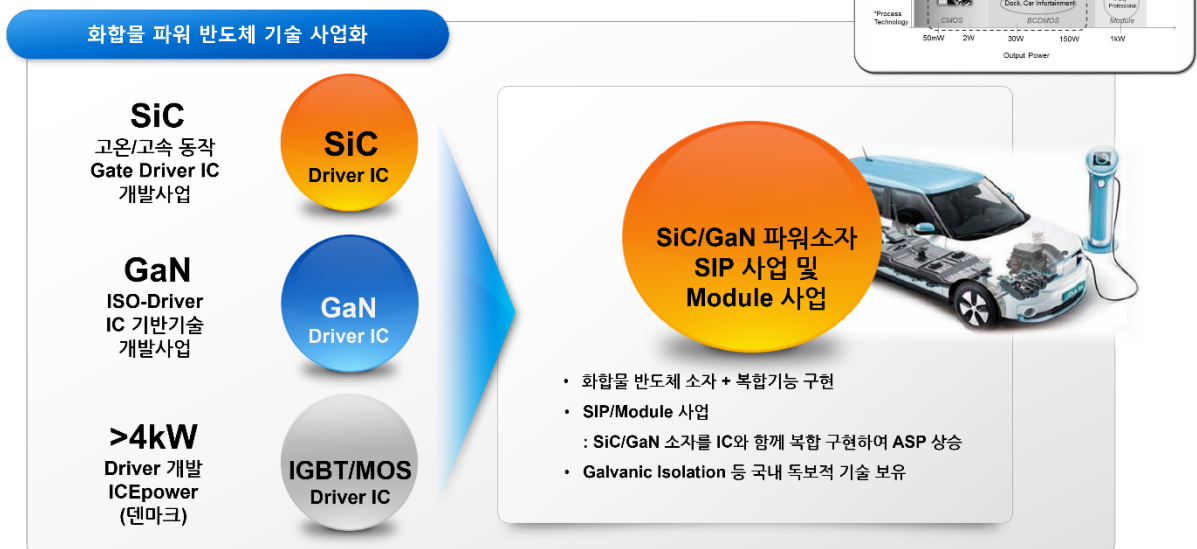
Analog-Digital-Power
in a **SingleSilicon™**
with valued software solution

IRON DEVICE AUDIO SOLUTION



IRON DEVICE POWER SOLUTIO

지속적 개발 중인 파워반도체 IP의 사업화 진행



※ 채용담당자 : 윤정 부장/ 010-8898-2218/ jyoona@irondevice.com



어보브반도체(주)



www.abov.co.kr

기업소개

어보브반도체는 "고객중심의 도전과 혁신"의 경영이념을 바탕으로 세계 MCU 시장의 정상적 자리에 도전하기 위하여 끊임없는 기술 개발과 R&D 투자로 고객과 함께 새로운 시장을 창출해 나가고 있는 **MCU(Micro Controller Unit) 전문 반도체 기업**입니다.

LG 반도체 시절부터 30 여 년을 함께 해 온 어보브반도체의 기술과 경험, 노하우는 국내외 IT 산업 발전의 디딤돌이 되었으며, 나아가 4 차 산업혁명의 핵심 아이콘으로 새로운 디지털 세상을 견인하고 있습니다.

주력 제품 / 서비스



- Microcontroller Unit

어보브반도체는 세계 4 위의 가전 MCU 전문 기업으로서 Consumer 부터 Automotive 까지 모든 전자, 전기 제품에 들어가는 8-bit/32-bit Microcontroller Unit 을 설계 및 공급 중이며 내부 연구소에서 Flash IP, Analog IP, Digital IP 와 관련된 세계적 설계 기술을 보유하고, 각종 Tool 관련 EcoSystem 을 자체 개발하여 전세계 800 여개 이상의 고객에게 제공하고 있습니다.

- Motor Solution

대형 가전과 소형가전의 모터 구동을 위한 풍부한 주변 장치 및 제어 알고리즘을 포함한 모터 제어에 관련한 토탈 솔루션을 제공합니다.

- Touch Solution

가전 및 모바일, 산업용에 폭넓게 사용되고 있고, 특히 터치와 디스플레이 기능이 통합된 응용에 최적화된 기능을 제공합니다.

- aBLE Series

어보브반도체의 자체 개발된 블루투스 저전력 기술과 초저전력 MCU 기술을 단일 칩으로 구현한 제품으로 스마트 리모컨과 사물인터넷 시장에서 요구하는 초저전력, 초소형 요구 사항에 적합한 제품입니다.

채용정보

모집분야	직무 내용	담당 업무
MCU 반도체 설계	[디지털 / 아날로그] 직접회로 설계	8비트 및 32-비트 MCU 설계 디지털설계 개발 도구 - RTL(Verilog) / FPGA - Synopsys / Cadence 아날로그설계 개발 도구 - Cadence / Hspice / Calibre
MCU 반도체 응용설계	반도체 응용설계 (FAE / AE)	Analog 신호 처리 반도체 응용 검증 개발 툴 개발 8Bit, 32Bit MCU 검증 및 개발 지원

- 전문연구요원(병역특례) 지정업체

산학연계 장학생 운영(산학연계 인력양성 프로그램)

목 적	대학교와의 최적화된 맞춤형 교육프로그램을 통하여 이론과 실무를 겸비한 우수인력 양성하여, 회사에 적합한 우수인력 확보
모집분야	· Digital / Analog Design
지원자격	· 전자공학 관련 학과 · 대학원 진학예정자(학점 3.5이상) 대학원 재학생 (학점 3.5이상)
지원내용 혜택/의무	· 등록금 전액 & 월 정액 장학금 지원 · 취업보장(학점유지) & 수혜기간 2배 의무근무

복리후생 제도

임직원의 생활안정을 도모하고 나아가 복지증진을 통한 임직원 삶의 질 향상을 추구

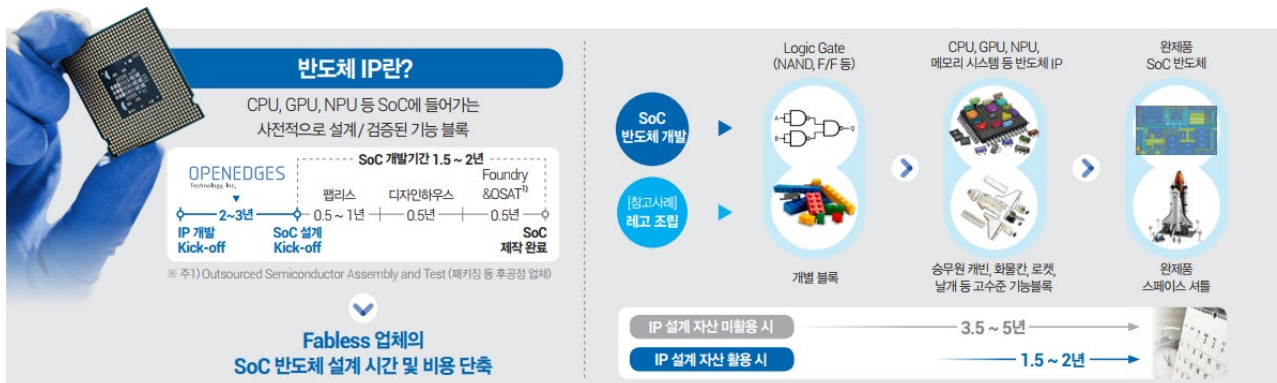
· 유연한 근무시간 · 성과보상 & 스톡옵션 제도 · 스톡옵션 제도 · 장학제도 운영 · 해외 어학 연수	· 우수사원 포상 · 종합검진 & 의료비지원 · 장기근속 포상 · 회사 콘도/리조트 시설 운영 · 기숙사 운영 등
--	---

- 근무지 : 서울 강남구 대치동 (2 호선 삼성역)
- 지원방법 : 홈페이지(www.abov.co.kr) 채용절차 참조(이메일 지원)
- 채용담당자 : 김종희 프로 / 02-2193-2341 / jonghee.kim@abov.co.kr

AI for Everyone, Everywhere

세계 유일의 AI 반도체 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 설계

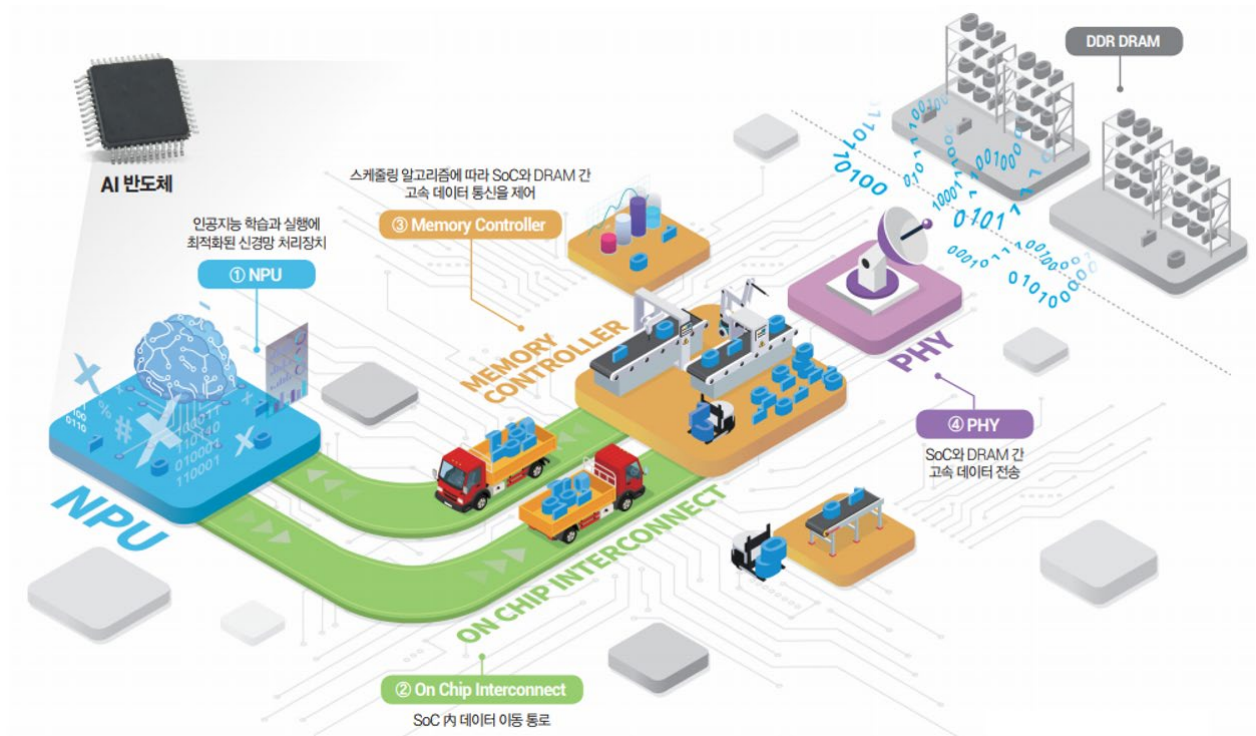
2017년 설립된 오픈엣지테크놀로지는 'AI for Everyone, Everywhere'라는 비전을 바탕으로 인공지능 기술을 자율주행자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(Intellectual Property, 지적재산)를 개발하는 기업입니다.



당사는 고성능 'Total Memory System IP Solution'과 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 'AI Platform IP Solution for Edge Computing'을 현재 전세계에서 유일하게 제공 가능한 회사입니다. 당사가 주목하는 엣지 환경은 서버 환경과는 달리 소비전력 또는 공간 측면에서 제약이 크기 때문에 이러한 제약 사항을 고려하여 경쟁사 대비 높은 소비전력/면적/메모리 효율성을 확보하여 AI 반도체 IP 기술을 선도하고 있습니다.



당사는 현재 신경망처리장치 NPU IP와 On-chip Interconnect IP, Memory Interface IP(Memory Controller IP, DDR PHY IP) 제품을 통해 엣지 환경의 고성능, 고집적 인공지능 시스템반도체에서 필요한 시스템 수준의 인공지능 컴퓨팅 솔루션을 공급하고 있습니다.



시스템반도체 설계 엔지니어를 꿈꾸는 분들의 많은 관심 부탁드립니다.

채용 직무	담당 업무
NPU 개발	· [RTL Design] NPU 연산장치 및 데이터 전송 장치 RTL 설계 및 검증 · [S/W] NPU Compiler, SDK, Linux Device Driver 개발
Memory Controller 개발	· DDR Memory Controller 설계 및 검증 · System Verilog 기반의 고속 파이프라인 구조의 Digital HW 기능블록 개발
DDR PHY 개발	· [Digital] Memory Interface PHY Architecture 설계, RTL 설계 · [Analog] 고속 Transceiver, Equalizer(CTLE, DFE) 설계
NoC 개발	· [RTL Design] On-chip Interconnect 구성요소 설계 및 검증 · [S/W] Graph/Network Structure 구현 및 최적화, 데이터 전달 및 계산
IP Verification	· IP Design 검증 (NPU, Memory Controller, Interconnect) · 검증 방법론, 검증 자동화 연구 및 적용

※ 채용담당자: Employee Experience 팀 한서환/ 02-2038-7507/ daniel.sh.han@openedges.com

◎ Company overview



- 회사명 : (주)원세미콘
- 창립 : 2018년 8월 16일
- 임직원 : 39명 (2022.8.29 기준)
- 사업 분야 : Memory companion IC chip (DDR4RCD, DDR5RCD 외)
- Homepage : <http://1semicon.com>

창립 동기

- 대한민국 Memory 산업 경쟁력 강화
 - 공정 미세화 둔화 → 고용량/고성능 solution 제공
 - 국가간 반도체 전략적 활용 → 안정적 공급으로 산업 보호
- 반도체 산업 변곡점에 대한 변화 요구 부응
 - 새로운 computer architecture 등장 (CXL)
 - Memory component를 system solution으로 확대 필요
 - Memory 중심의 대한민국 산업계를 비Memory로 확대
- 고급 숙련 인력 조기 은퇴/국외 유출 방지 및 신규 인력 양성

산업 환경 변화 → 새로운 기회, 미래 반도체 산업 개척

◎ ONE Semiconductor : memory solution innovator

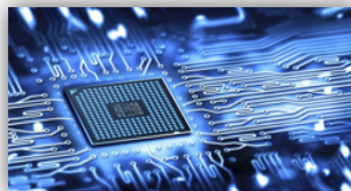
"ONEsemicon" is a Memory Solution Innovator

Company



- Core competences in high-speed memory interfaces and ASIC product development
- Innovations offering low power & high performance in memory and memory systems

Technology



- DDR4/DDR5 RCD for RDIMM
- Current project of DDR5 Clock Driver for UDIMM/SoDIMM
- Advanced memory related technology and research for next-generation products

QoS



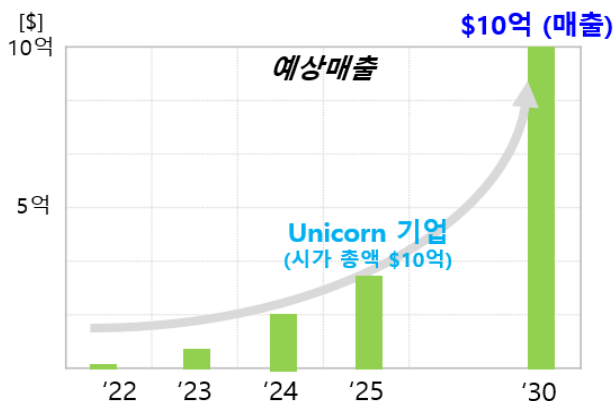
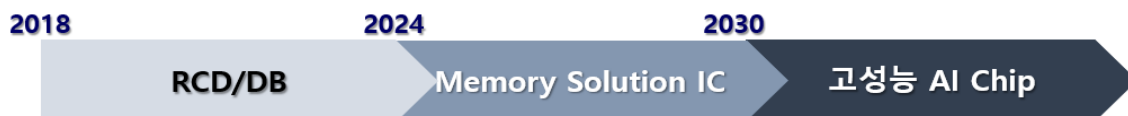
- QMS (Quality Management System)
- High quality (~ <20ppm)
- 24/7 technical support

◎ ONE Semiconductor 사업 현황 및 중장기 Vision

- 사업 현황 : DDR4RCD 개발 완료 ('22년 3분기 양산)
DDR5RCD 개발 중 ('22년 4분기 양산 예정)
ASIC 기술 기반 Memory Solution 준비 중 ('24이후 양산)



양산 개발한
DDR4RCD
Chip



- 수평적 의사소통, 자율적 연구 문화
- 인재 육성 및 빠른 성장 기회 제공
- 성장과 비례한 대우 수준 향상 (세계 최고 목표)



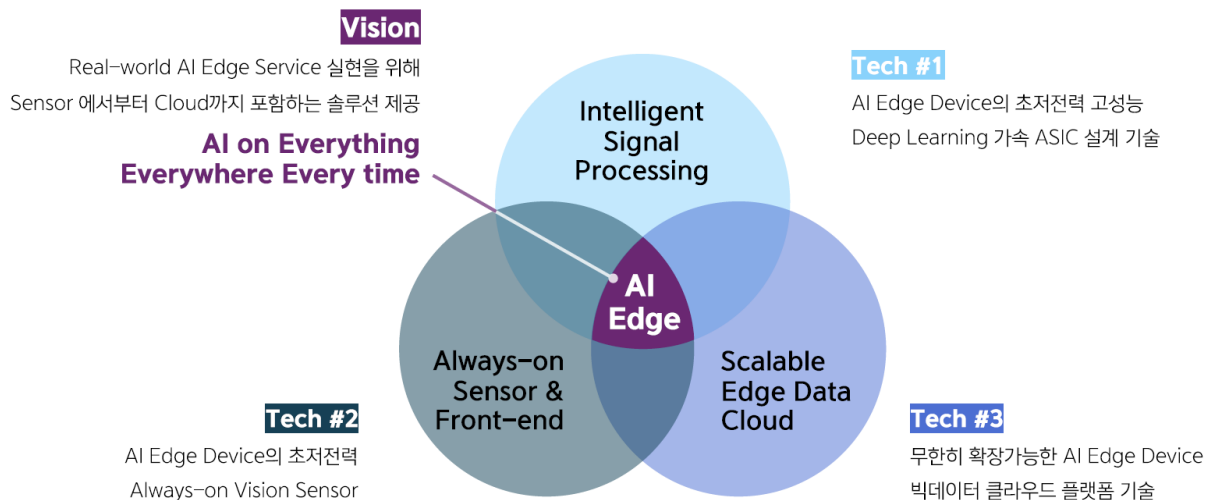
◎ (공고) ONE Semiconductor 엔지니어 인력 채용

모집대상	반도체 설계 Engineer (홈페이지: http://1semicon.com)	
모집인원	Digital Logic 설계	Analog/Mixed IC 설계
	○ 명	○ 명
담당업무	RTL 기반 Digital IP 설계 및 Full Chip 검증	Analog & Mixed IC 설계
개발제품	반도체 IC (Memory 관련 Buffer Chip, Clock Driver, I/O Interface 外 다수)	
필요 역량	반도체, 전기, 전자, 컴퓨터 공학 관련 전공자 (학사/석사/박사)	
	- Digital 설계 이해 - Verilog 기초 이해 - Linux 개발 환경 이해	- Mixed Signal IC 설계 이해 - SOC 설계 방법론 이해
우대 사항	- Digital 회로 설계 유경험자 - Python, Perl, Tcl 등 Script 사용 유경험자	- Analog 회로 설계 유경험자 - Gbps급 고속 Interface 설계 경험자 - Signal Integrity 관련 회로 설계 경험자
처우	급여: 경력 및 보유 역량에 따라 결정 기타: 교통비, 식사, 건강검진비 지원 ※ '병역 특례 대상자' 지원 가능 (전문요원 병역 특례 업체 지정, 2018년~)	상여: 사업 성과에 따른 성과급 지급
문의	인사 담당자 (한이슬 대리: 031-548-2651, e-mail : ls.han@1semicon.com) (오현석 부장 : power5440@1semicon.com)	

AI를 실생활에서 실현하기 위해 Edge에서 Cloud까지 최적화 된 솔루션을 제시하는 기업

- 유엑스팩토리는 인공지능 가속 하드웨어 및 관련 소프트웨어 기술을 개발하고 있는 회사입니다.
- 국내외 System-on-Chip, 시스템, 소프트웨어 개발 회사 및 연구소 등에서 활용 가능하도록 인공지능 솔루션을 최적화하여 판매하고 있습니다.
- 단순 연구위주의 H/W가 아니라 H/W를 서비스에 도입하기 위한 Software 및 Cloud 플랫폼까지 제공하는 유일한 기업입니다. 연구 및 양산 전문인력을 보유하고 있으며, 다수의 국가 R&D 과제 선정을 통해 역량을 인정받고 있습니다.
- 국내외 다수 연구기관, 반도체 설계 회사와 협력관계를 구축하여 다양한 분야의 사업화 노하우를 보완하고 있습니다.
- 다양한 프로토타입 개발 경험을 바탕으로 하여, H/W에서부터 S/W까지 AI 서비스를 성공적으로 시장에 도입할 수 있도록 하는 솔루션 제공 기업입니다.

UXF는 3가지 핵심 역량을 바탕으로 진정한 의미의 **Edge AI**를 실현하고 제시할 수 있는 토탈 솔루션 제공 기업입니다.



- 사용자와 가장 가까이 접하는 Edge Device에서 이들이 수없이 연결 될 Cloud Node 까지의 길을 제시하여 AI를 기반으로 Edge UX를 실현하는 것이 UX Factory의 역할입니다.
- Real-World AI Edge Service 실현을 위해 Sensor에서부터 Cloud까지 포함하는 솔루션 제공합니다.
 - Tech 1) AI Edge Device 초저전력 고성능 Deep Learning 가속 ASIC 설계기술
 - Tech 2) AI Edge Device의 초저전력 Always-on Vision Sensor 신호 처리 기술
 - Tech 3) 무한히 확장 가능한 AI Edge Device 빅데이터 클라우드 플랫폼 기술

회사 개요

설립시기	2015 년 08 월 25 일
소재지	경기도 성남시 수정구 청계산로 686 반도아이비밸리 714 호~716 호
직원수	17 인
핵심기술분야	AI SoC&Solution
주력 아이템	NPU IP, 초경량 AI 솔루션, 바이오 인포매틱스용 AI 플랫폼
특허보유 현황	등록 7 건/출원 9 건

주요 구성원 소개

박준영 대표이사	KAIST 전기및전자공학과 Ph.D(2014)
노승수 이사	KAIST 반도체설계응용연구센터 (2004~2014))
신종호 이사	삼성전자 (2007~2020)
이혜진 이사	KAIST 생명과학 Ph.D(2016)

※ 채용담당자 : 김현송 매니저/ 070-4173-1900/ hskim@uxf.ai



(주)이미지스테크놀로지

www.imagis.co.kr



회사 정보

회사명	(주)이미지스테크놀로지
대표이사	김 정 철
주소	수원시 영통구 광고로 105 경기R&DB센터 301호
임직원수	40명
보유 특허	107개(등록기준)
매출	213억 (2021년)
홈페이지	www.imagis.co.kr

연혁

- 2020 Sensor IC 승인 및 양산
- 2016 Fin tech 용 MST IC 승인 및 양산
- 2015 Xiaomi's Excellent Delivery Partner 수상
- 2013 C-Touch IC 승인 및 양산
- 2010 KOSDAQ 상장
- 2007 세계 최초 Haptic IC 승인 및 양산
- 2005 Video Encoder IC 승인 및 양산
- 2004 (주)이미지스테크놀로지 설립

주요 제품군

Haptic IC

사용자에게 촉감 전달을 위한 Actuator Driver IC

지원 가능한 Actuator Type

ERM (Eccentric Rotating Mass)

LRA (Linear Resonant Actuator)

C-Touch IC

Capacitive Touch 솔루션

AMOLED 디스플레이 터치 솔루션

터치 키 솔루션

MST IC

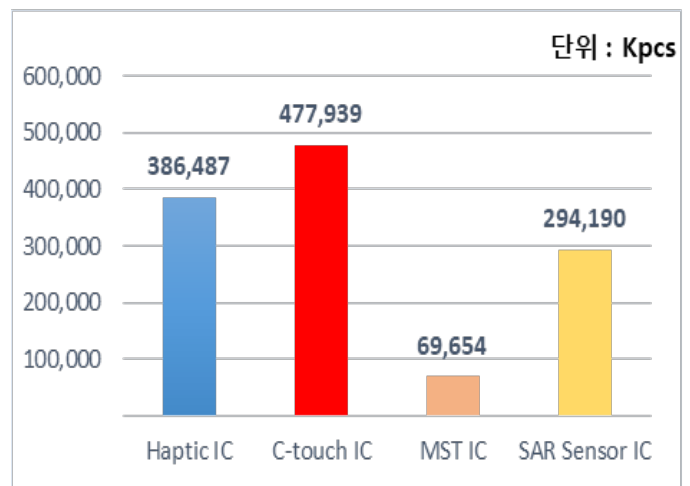
전자 결제용 Magnetic Secure Transmission IC

ex) 삼성 페이

SAR Sensor IC

유해 전파를 저감시키기 위한 근접센서 솔루션

제품별 누적 출하량



주요 고객사



SAMSUNG DISPLAY



● 기업 인증



ISO9001/ ISO14001 / Samsung ECO Partner

코스닥 상장법인 / 벤처기업 / 이노비즈 인증

● 직무 및 요구역량

- 혼성 신호 제품의 Analog Front End 회로 설계
 - 반도체 소자, CMOS 공정에 대한 이해
 - 아날로그 기본 회로 및 CMOS OP Amp, ADC, DAC, PLL 등에 대한 이해
 - 회로 Simulation을 위한 기본 지식 필요
- 혼성 신호 제품의 디지털회로(Control Logic)설계
 - 반도체 소자, CMOS 공정에 대한 이해
 - Combinational Logic 및 Sequential Logic 설계
 - 회로 Simulation을 위한 기본 지식 필요

● 복리후생 제도

- 4대보험, 퇴직연금 운영, 식대, 주차비 지원
- 장기근속 휴가 및 포상, 종합건강검진 지원
- 전세자금 무이자 대출, 콘도/리조트 이용권
- 명절 선물, 생일 및 결혼기념일 지원
- 각종 포상금(특허, 스톡옵션, 인센티브 등)
- 탄력근무제 및 52시간제 준수, 자유복장
- 사무실 별도 에어컨 및 공기청정기 운영

● 채용 담당자

인사담당자

- 경영지원팀 김영호 팀장
- 연락처 : 031-888-5269,
- 이메일 : yhkim@imagis.co.kr

연구소

- 윤병진 연구소장
- 연락처 : 031-888-5280
- 이메일 : bjyoon60@imagis.co.kr

(주)자람테크놀로지는 2000 년 1 월 설립된 비메모리 시스템 반도체 설계 전문기업입니다. 5G 모바일 백홀 연결에 사용되는 10 기가급 XGS-PON SOC 칩과 하이패스 단말기용 ASIC, PABX 교환기용 ASIC 칩등과 당사가 개발한 칩이 내장되는 통신 모듈과 장비를 생산, 판매하고 있습니다.

글로벌 통신반도체 설계 전문기업



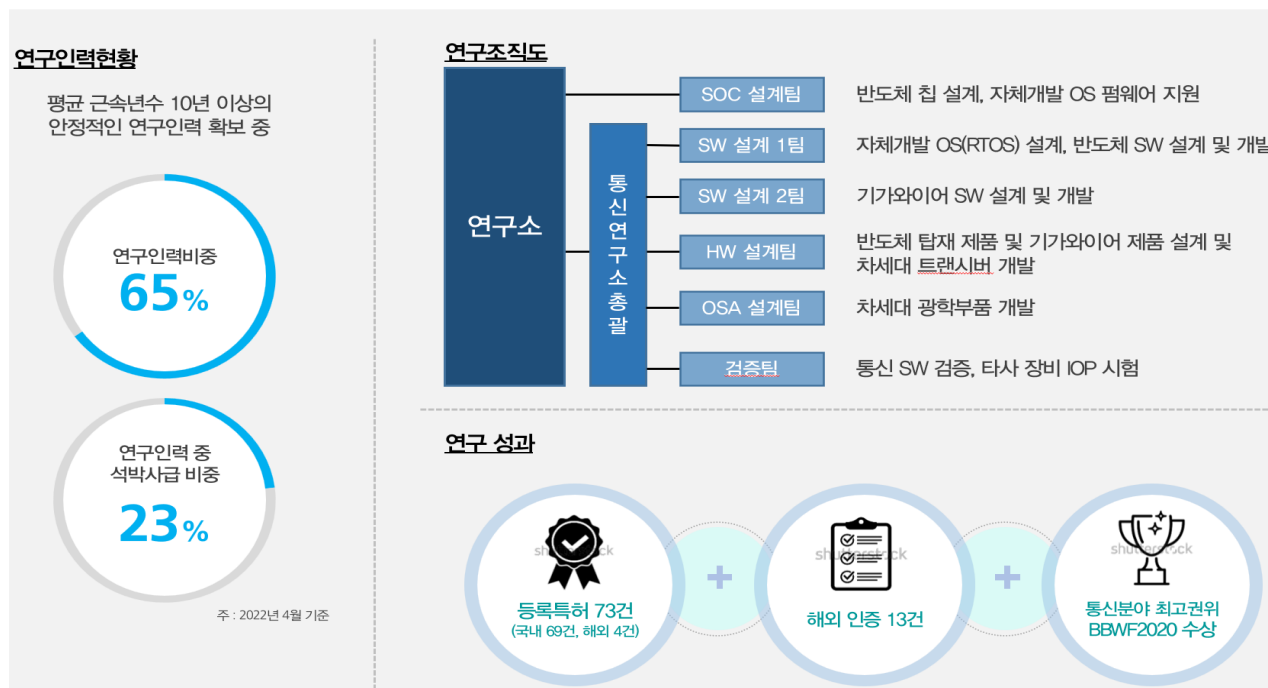
자체 개발한 RISC-V 기반 프로세서를 사용하여 응용분야에 최적화 된, 원가경쟁력을 확보한 칩을 생산, 판매하고 있습니다.

유무선 통신 전 분야를 아우르는 사업영역



우수한 R&D 인적자원을 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 개발, 판매하고 있으며, 글로벌 Top Class 고객사들에게 제품을 공급하고 있습니다. 대한민국 기술대상, 전파방송 기술대상, BBWF 최고제품상등 다양한 수상경력을 통해 당사의 우수한 기술력을 인정받고 있으며, '22 년 하반기 코스닥 상장을 준비하고 있습니다.

우수한 R&D 인적자원을 바탕으로 국제 표준을 능가하는 개발 기술 확보



Know-How

오랜 경험 기술 노하우 기반 통신반도체 설계 능력

1

Technology Advantage

프로세서/SoC/CPU-MicroCode 설계 기술과 RTOS 기반 SW 스택 기술 보유

2

Unique

원가경쟁력을 비롯 저전력, 시각 동기화 제품 경쟁력 확보

3

Partnership

국내는 물론 해외의 다양한 고객사 확보

4

Stable Growth

자체 통신반도체 칩이 적용된 통신 장비의 안정적 매출 성장 지속

5

Potentiality

글로벌 경쟁사 대비, 기술경쟁력을 확보한 차세대 통신 반도체 글로벌 리딩 컴퍼니

6

Chance

자율주행과 전 사업의 디지털화로 5G/6G 산업 본격 성장

7



No.1 통신반도체 설계 전문 기업
자람테크놀로지

당사와 함께 국내 시스템 반도체 산업의 성장을 이끌어갈 인재를 모십니다.

※ 채용담당자 : 박경희 부장/ khpark@zaram.com/ 031-779-6701

◇ 회 사 개 요

회 사 명 : (주)지니텍스 (ZINITIX Co., Ltd)

대표이사 : 호 경 근

설 립 일 : 2000년 5월

상 장 일 : 2019년 KOSDAQ 상장

임직원수 : 88명 (2022년 7월)

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 흥덕IT밸리 19층

주력제품 : Touch controller IC, AF Driver IC, Haptic Driver IC, FinTech IC

매 출 액 : 388 억 (2021년)

홈페이지 : WWW.ZINITIX.COM

◇ 회 사 소 개



지니텍스는 System IC 전문기업으로 창립 이후 지속적인 연구개발을 바탕으로 Touch Controller, AF Driver, Haptic, Motor, Power Driver IC, 핀테크 IC 등 다양한 반도체를 개발/양산하고 있으며, 당사의 제품은 Smart Phone, Tablet 등의 모바일 기기, Note-PC, Home Appliance 및 Automotive에 이르기까지 폭넓고 다양한 분야에 적용되어 시장과 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있고, 끊임없는 혁신과 시장을 선도하는 기술을 개발하여, 최고의 제품을 통해 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 Global System IC Leader가 되겠습니다.

◇ 회 사 연 혁

- 2000년 법인설립
- 2006년 IR52 장영실상 수상 / 대한민국 기술혁신대상 최우수상 수상
- 2009년 NICE그룹 편입
- 2010년 대한민국 반도체설계대전 지식경제부장관상 수상

- 2012년 삼성전자 1차공급업체등록
- 2014년 (주)위더스비전 합병 / 3000만불 수출의탑 수상
- 2015년 World Class300 기업선정
- 2017년 IC칩 10억개 공급생산
- 2018년 화웨이, 샤오미 스마트워치 터치IC공급
- 2019년 코스닥 상장
- 2020년 웨어러블 터치IC 세계시장 1위 달성
- 2021년 산업통산부 이달의 산업기술상 수상 / 대한민국 기술대상 국무총리상 수상

◇ 주 요 제 품



◇ 인 재 상

- 열정적이고 진취적인 기상을 가지고, 끊임없이 새로운 것을 추구하며, 아이디어와 독창성을 가지고 실패를 두려워하지 않은 도전정신을 가진 인재

◇ 복 리 후 생

- 자녀학자금 / 잔업, 휴일특근비 / 경조사제도 운영 / 리조트(콘도)운영 / 동호회활동 지원
- 사내 외국어 강좌 운영 / 장기 근속자 및 우수사원 포상 / 중·석식 제공
- 시차출퇴근제 (9~10시 출근, 18~19시 퇴근) / 생일자 선물(케이크쿠폰)
- 부서별 조직 활성화비 지원 / 발명특허 보상금 지급 / 사내인력 추천 장려금
- 각종 외부 교육 지원 및 해외 전시회 참관 기회
- 각종행사실시 : 체육대회, 워크샵, 계층별 간담회 등

◇ **채용담당자** : 경영관리실 이범신 차장/ 031-8065-6003/ E-mail : bslee@zinitix.com

칩스앤미디어는 Video Codec을 중심으로 다양한 알고리즘을
고효율의 반도체 IP로 구현하는 **반도체 설계 자산(IP) 기업**입니다.

직원의 80% 가량이 개발자이며, 개발자가 근무하기 좋은 환경을 위해 끊임없이 고민합니다

위치

서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성역)

IPO

코스닥 상장(2015.08.05)

규모

중소기업

Overseas

미국, 중국, 대만, 일본

Product

주력 제품 Video Codec 외 ISP및 Computer Vision

▶ 반도체 설계(비디오IP) 전문 기업

- 칩스앤미디어는 국내 최초로 코스닥 상장된 **반도체 IP 기업**이에요.
- 약 20 년간 비디오 IP 연구를 해오며 **150 여개의 국내외 고객사를 확보**하며 자리를 잡았어요.

▶ 안정적으로 성장하고 있는 기업

- 회사의 **매출이 매년 꾸준히** 증가하고 있어요.
- 재고의 위험과 설비 투자의 비용이 없어 **인적자원 투자에 더욱 집중**할 수 있어요.

▶ 개발자를 위한 환경을 제공하는 기업

- 사람마다 집중할 수 있는 업무 시간은 모두 다르다고 생각하기에, 최소한의 협업을 위한 Core Time 만 두고, **유연근무를 시행**하고 있어요.
- 비디오 IP 업계의 전문가와 근무하며 해당 연구 분야의 **전문가로 성장**할 수 있는 기회가 열려 있어요.

유연근무제도

- 업무 집중 및 개인의 삶의 조화를 위해 Core Time(11:30 ~ 15:30) 이외의 시간은 개인 스스로 자유롭게 근무

Refresh 휴가 지원

- 충분한 휴식을 위해 4년 주기로 Refresh 휴가와 휴가비를 지급

수평적인 조직 문화

- 회사의 구성원 누구나 동등한 위치에서 업무를 수행하기 위해 직급과 이름 대신 영어 닉네임만을 활용하여 소통

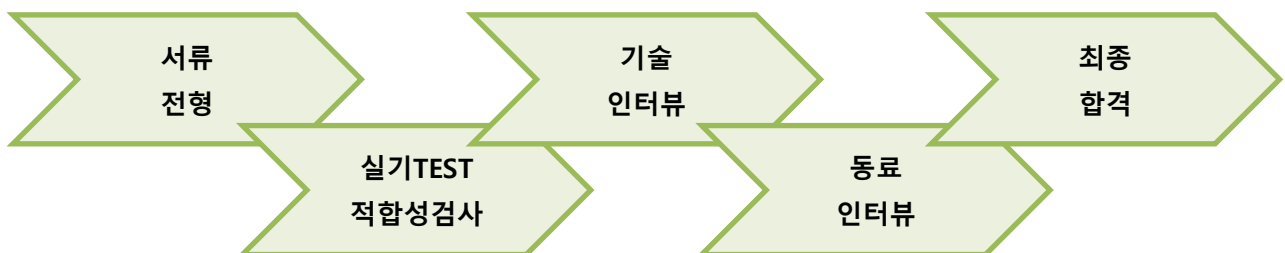
보상 제도

- 성과와 역량에 근거한 성과급 체계 운영
- 뛰어난 업무 역량을 보유한 직원을 대상으로 Fast Track(조기승진제) 시행

복리후생

- 선택적 복리후생비 지급 (연 300 만원)
- 무이자 주택자금 대출 : 최대 5 천만원
- 매년 고급 건강검진 지원
- 어학 및 업무 관련 교육비 지원
- 동호회 활동 지원 등

▶ 채용 프로세스



궁금하신 내용은 편하게 문의 주세요.

카카오톡 오픈채팅 "칩스앤미디어 채용 캐주얼챗"

채용담당자 : 이선미 대리/ 02-568-3767/ sarah.lee@chipsnmedia.com



(주) 커넥스트



www.conextt.com

Conextt Inc.

Our company provides IOT/Automotive Semiconductor manufacturing solutions.

1. Company Overview

Company Name	Conextt Inc.
Founded	2015.08.04
CEO	Hong Jong Wook
Business Portfolio	Semiconductor Design/Verification Service
Location	Office 1 : Nongseo-dong T-10053,11, SeoCheon-ro 201beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do Office 2 : 2th Floor, 28, Mabang-ro Seocho-gu, Seoul (RBS)
Contact	070-4211-8996
Employees	32

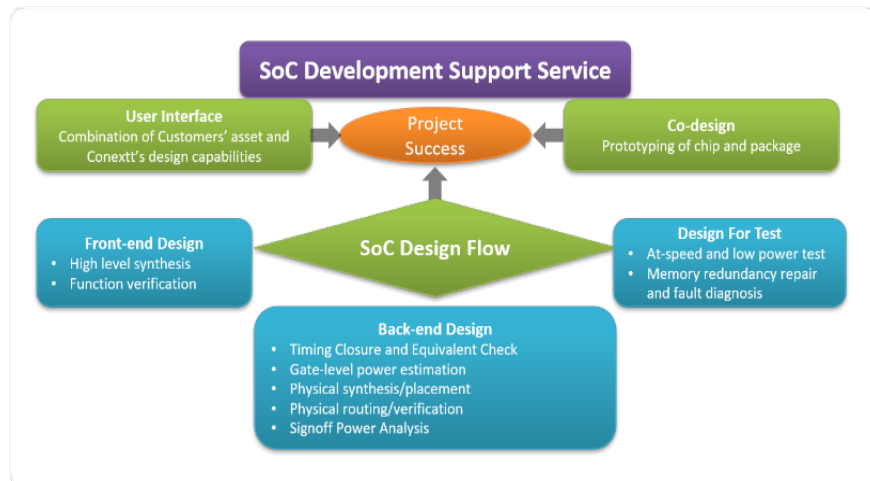
2. Company History

- 2015.08 : Conextt Inc. was founded
- 2015.12 : Won a KSIA* Project of Semiconductor IP Verification and Commercialization
- 2016.06 : Won a ICT Future Tech Project of MoSIF**
- 2016.09 : Certification of Venture Company
- 2017.02 : Certification of R&D Center
- 2017.04 : Developed Low-power BLE Chipset (SMIC, 50nm)
- 2017.05 : Received BLE 4.0 Protocol Stack Bluetooth SIG Certificate, first in Korea
- 2017.08 : Started the Design Service Business with Samsung Electronics
- 2018.10 : Design partner (VDP) contract with Samsung Electronics
- ~Current : Providing SoC design & verification service for SEC FDS & SystemLSI

3. Business

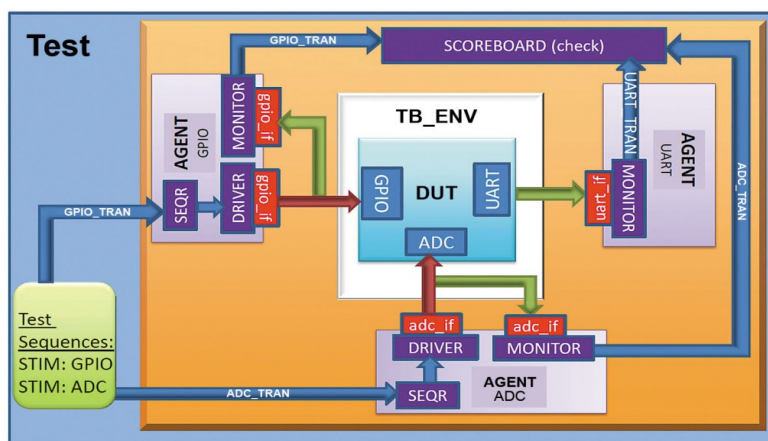
■ SoC/Chipset/MCU Design Service

- ✓ ARM Cortex M/A/R series based SoC Architecture/Platform Development
- ✓ AP SoC Integration Design (IPXACT/Magillem Based)
- ✓ Meridian CDC/Spyglass DFT/Lint(IPXACT, RTL, DC)/VCLP/UPF/Synthesis/SDC
- ✓ Various IP Design (Video/Audio/Display/Bus Component/Algorithms)



■ SoC/Chipset/MCU Verification Service

- ✓ UVM/System Verilog Based Verification
- ✓ Scenario based Testbench & Test code development
- ✓ Main/Local Bus Verification based on IWB environment (Cadence)
- ✓ Performance Verification (PV) based on IWB environment (Cadence)
 - : Bandwidth Analysis/Peak Performance Analysis/QoS Analysis etc
- ✓ AP SoC BLK/AP System Component/Digital IP/Analog IP Verification



■ PDK Development

- ✓ PDK development project with SEC Foundry

※ 채용담당자 : 조아라 대리/ 070-4211-8996/ arjo@conextt.com

[Group History]

Group History



[Group Chart]

Group Chart

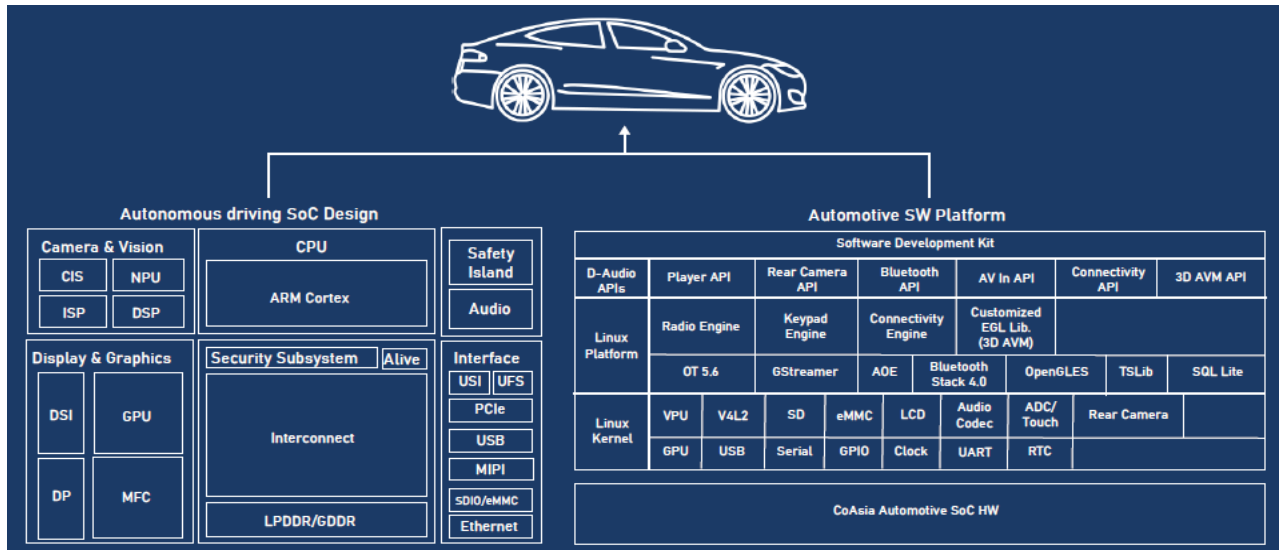
Number of Employees : Approximately 5,000
Volume of Sales : Approximately 1.5 trillion won



[Business Areas]

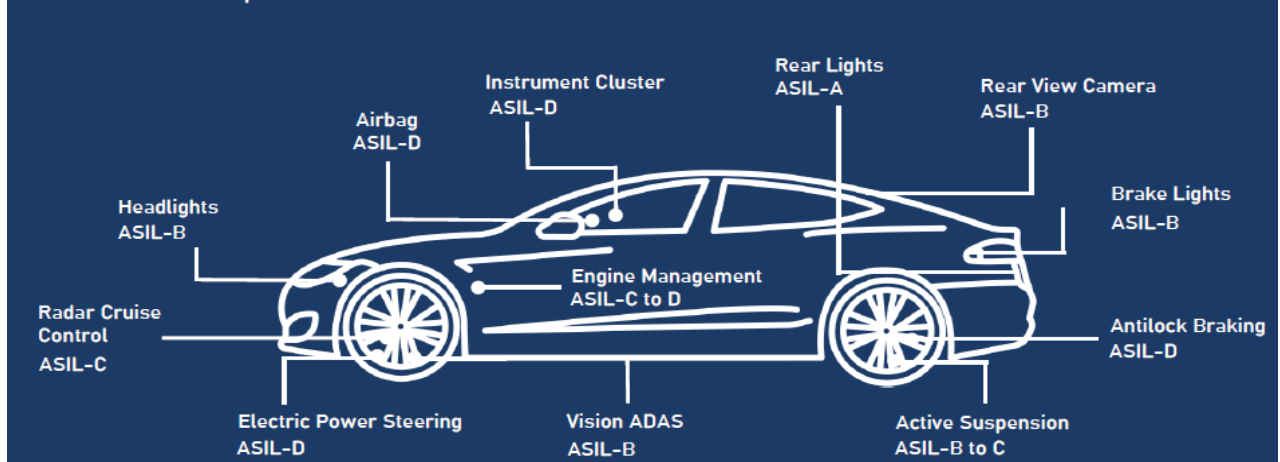


[Automotive SoC Development Capabilities]



[Solution Capabilities for Automotive Safety Issue]

CoAsia is able to design automotive SoC with ISO26262 processes which meet the requirements of ASIL B-D



※ 채용담당자 : 이선희 과장/ 02-2283-7400/ lsh9734@coasia.com

공식홈페이지: <https://q-semi.com/>

채용사이트: <https://qualitas.recruiter.co.kr>

개요

설계 및 개발을 전문적으로 수행하는 **IP & 팹리스 기업**으로
뛰어난 아이디어와 우수한 칩 설계 기술을 바탕으로 반도체 칩 개발에 집중합니다.



고속 통신용 회로설계 분야에 있어 국내 최고 수준의 기술력을 갖추고 있습니다.
4차 산업혁명을 대표하는 인공지능, 자율주행 등 방대한 양의 연산을 요하는 응용분야에 필요한
Interconnect IP 기술을 기반으로 IC, Module 까지 연구/설계하는
Total Interconnect Solution Provider 입니다.

현존하는 최대 전송속도인 **112Gb/s** 급의 **SERDES IP** 를 **국내 최초로 확보**했으며,
세계에서는 7 번째로 112Gb/s SERDES IP 를 개발하였습니다.
현재 **Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) IP 파트너**로 협업 중이며,
향후 SERDES 를 기반으로 한 SoC와 모듈 시장에도 진입해
데이터센터를 비롯한 다양한 산업으로 솔루션을 확장할 계획입니다.

고객 확장성

삼성전자 파운드리 국내 유일 IP협력사
글로벌 선도기업 8개 이상 업체와
라이선싱 체결 및 협의 진행 중



지적재산권 보유 현황

국내등록 7건 / 국내출원 19건
미국등록 2건 / 미국출원 2건
중국출원 3건



임직원 현황

2017년 2명으로 시작하여
현재 104명이 재직 중
내년까지 20명 이상 추가 채용 계획



기업공개(IPO) 예정

주식 상장 본격 추진 중
코스닥 입성 예정



엔지니어가 행복한 회사

1 업무를 통한 자기계발

회소가치가 있는 고급 회로설계 엔지니어로 성장할 수 있도록 구성원의 전문 역량 개발에 힘씁니다.
경험이 풍부한 기술 전문가 리더들이 직접 실무를 코칭하고,
다양한 기술 전수 교육 및 학술행사를 실시하고 있으며,
업계 최고 수준의 경쟁력을 갖추 수 있도록 아낌없이 지원합니다.

- 엔지니어 주도의 전략기획 | 내부강사 기술 세미나 | 사외교육&컨퍼런스 | 사내 학술행사 | 명사특강

2 성과에 합당한 보상체계

지속적인 교육 및 면담을 통해 구성원 개인의 상황과 역량에 맞는 목표 설정을 도와주고,
공정한 기회 부여 및 업무 분장을 진행하며,
회사 성과와 개인 기여도에 근거하여 합당한 보상을 실시합니다.

- 개별 연봉제 및 연말 성과 인센티브 | 1on1 정기면담제도 | 연말 특별 휴가 | 우수인재 프로그램

3 자유롭고 편안한 근무 환경

구성원 모두의 헌신과 노력을 존중하기에 유연하고 즐거운 일터를 만들고자 합니다.
원하는 시간에 출퇴근하고 가장 몰입할 수 있는 공간에서 일할 수 있으며,
콘솔게임, 보드게임, 도서를 즐길 수 있는 공용 공간이 마련되어 있습니다.

- 재량근로제(자율출퇴근) | 스마트오피스 | 대체휴무제도 | 오피스카페 | 휴식공간

4 윤택한 삶을 위한 다양한 복리 후생

구성원들이 윤택한 삶을 누릴 수 있도록 노력합니다.
제2 외국어 정복하기, 운동 습관 다지기 등 평소 하고 싶던 모든 일들과
풍족하고 맛있는 끼니를 위해 금전적으로 지원합니다.
건강 및 생활 전반에서 도움이 되고자 마음으로 챙겨 드립니다.

- 자기계발비 연 120 만원 | 식대 월 50 만원 | 종합건강검진 지원 | 명절 귀향비 | 경조금

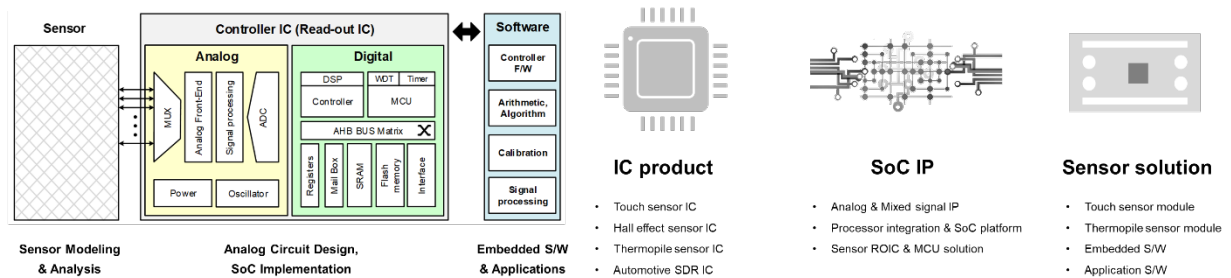


※ 채용담당자 : 임형순 주임연구원/ 02-555-3305 / hs.lim@q-semi.com

“ Human interface SoC total solution

회사 제품 설명

(주)큐버모티브는 시스템반도체 전문 팹리스 기업으로서, 센서 특성 분석, 고성능 아날로그 및 디지털 회로 설계 기술, 임베디드 소프트웨어 기술을 모두 보유하고 있으며, 핵심 보유 기술을 바탕으로 IC 제품, 시스템반도체 IP, 센서 모듈 제품을 공급하고 있다.



고성능 터치센서 IC 제품

(주)큐버모티브는 현재 4 종의 터치센서 IC 제품(CMT024, CMT060, CMT084, CMT126)을 생산 판매 중에 있다. (주)큐버모티브의 터치센서 IC 제품은 기존 제품 대비 감도, 정확도, 전력 소모 면에서 월등한 성능을 제공하므로, 터치 시장에서의 점유율이 점차 확대하고 있다.

CMT024 제품은 웨어러블 기기 및 가전 제품 터치 센서에 적용되는 IC 로서, 초저전력, 고감도, 고신뢰성이 강점이다. CMT024 현재 리모컨, 조이스틱, 커피머신, 인덕션 등에 적용되고 있다.

CMT060 제품은 flexible OLED 디스플레이에 적합한 터치스크린 IC 로서, 1-nF 이상의 기생 정전용량을 제거할 수 있는 혁신적인 기술력이 적용된 제품이다. CMT060 은 5 인치 – 12 인치 터치스크린에 적합한 제품으로서, 현재 PDA, 태블릿, 산업용 터치 모니터에 적용되고 있다. 현재 개발 중인

CMT084 제품은 10 - 16 인치 터치스크린에 적합한 제품으로서, 고속, 고감도, 고신뢰성이 강점이다. CMT084 는 POS, 소형 KIOSK 는 물론 차량용 디스플레이까지 지원할 수 있다.

CMT126 제품은 20 – 40 인치의 중대형 터치스크린에 적합한 제품으로서, 고감도, 멀티-칩 확장성이 강점이다. 현재 POS, KIOSK, 산업용 터치 모니터 등에 적용되고 있다.

CMT126 : 15 – 40" (M/P)

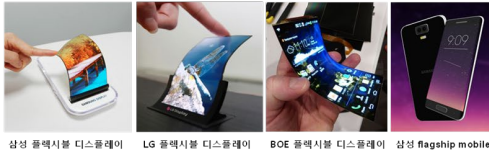
; POS, KIOSK 중대형 터치스크린 IC

**CMT084 : Automotive touch IC (M/P)**

; 21.4Q, 차량용 디스플레이용 터치스크린 IC

**CMT060 : Flexible OLED Mobile (M/P)**

; 플렉시블 스마트폰, Flexible display 터치스크린 IC

**CMT024 : Wearable & Home appliance (M/P)**

; 초저전력 / 고신뢰성 터치센서 IC

**센서 솔루션**

(주)큐버모티브는 다수의 센서 전문 소프트웨어 개발 인력을 보유하고 있고, 양산 중인 터치 IC 제품 응용 경험을 통해 다양한 센서 모듈 개발 및 알고리즘 기술을 확보하고 있다. 이러한 기반 기술을 활용하여, 고객 요청에 따라 터치 센서 모듈 제품을 공급하고 있으며, 최근 COVID-19 상황 대응을 위한 비접촉 온도 센서 시장에도 진입하여, 센서 솔루션 사업 범위를 점차 확대하고 있다.

시스템반도체 IP

(주)큐버모티브는 IC 양산 경험이 풍부한 아날로그, 디지털, 소프트웨어 전문 개발 인력을 보유하고 있고, 실제 제품 적용으로 검증된 다수의 아날로그 및 SoC IP 를 보유하고 있어, 신뢰성 높은 시스템반도체 IP 를 제공한다. 최근 산업통상자원부의 시스템반도체 핵심 IP 개발 사업 지원으로, 다양한 종류의 시스템반도체 IP 를 확대 개발하고 있다.

Analog & Mixed-signal IPs	Silicon probe	In development	SoC solutions	Details
Oscillator	KF 130-nm / 180-nm, SEC LF6s	SKH 110-nm, GF 55-nm	CPU integration	ARM, Tensilica, Ensilica, Risc-V, I/D Cache
PLL	KF 130-nm, SKH 110-nm	SEC LF6s, GF 55-nm	BUS	AMBA/AHB, PIF BUS
BGR	KF 130-nm / 180-nm, SKH 110-nm	SEC LF6s, GF 55-nm	Memory interface	eFlash, EEPROM, SRAM, DRAM controller
LDO	KF 130-nm / 180-nm, SKH 110-nm	SEC LF6s, GF 55-nm	Network	Ethernet MAC, WiFi MAC
Charge pump	KF 130-nm / 180-nm		Communication	Viterbi, LDPC with DMA Function
POR	KF 130-nm / 180-nm, SKH 110-nm, SEC LF6s	GF 55-nm	Signal processing	RCF, IIR, FIR, Rot, Cordic, FFT with DMA Function
PAD, ESD-IO	KF 130-nm / 180-nm	SKH 110-nm, SEC LF6s, GF 55-nm	Interface	SPI, UART, I2C, EBI, USB1.1, MIPI, I3C
PGA	KF 130-nm / 180-nm	SKH 110-nm, SEC LF6s	Video	MPEG4, ISP, Video Enhancer
LPF	KF 130-nm / 180-nm	SKH 110-nm, SEC LF6s	Audio	I2S TX/RX, I2S 7.1, SPDIF, PDM, ASRC
Delta Sigma ADC	KF 130-nm / 180-nm	SKH 110-nm, SEC LF6s	Protection	AES/DES, SHA/HMAC, RSA/ECC
SAR ADC		SKH 110-nm, SEC LF6s	Peripherals	Timers, Watch-Dog Timer, GPIO, PWM, DMA, PMU
DAC		SKH 110-nm, SEC LF6s		

※ 채용담당자 : 김민정 차장/ 031-706-3707/ eva@cubermotive.com

회사소개

테크위드유는 2016 년 12 월 반도체 개발업, 제조 판매업을 목적으로 설립하여 기술집약적이며, 고품질의 Analog IP 및 제품을 공급하는 국내 Fabless 반도체 설계 회사입니다.

산업용 시스템에서 필요로 하는 고수익 다품종 아날로그 제품 위주로 개발하고 있으며, 부가적으로 초미세 공정용 아날로그 기반 설계기술의 확보를 통해 Analog IP 들을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다.

회사개요

설립시기	2016.12.20.
대표자	김 형 래
사업자	법인사업자
소재지	경기도 수원시 영통구 반달로 105, 2 층 (영통동)
직원수	31 명

핵심역량

업종/업태	반도체 제조업, 개발업
핵심기술분야	산업용 PMIC, Analog IP
주 아이템	Industrial PMIC
특허보유수	등록 2 건 출원 6 건
주요거래처	 

서비스 및 아이템 소개

- 1) Mixed-signal IP & Platform
 Generic Analog IP (LDO/POR/VLD/ADC 등)
 Power management IP (DC-DC Converter 등)
- 2) Industrial SoC
 Sensor Read-out IC
 DC Motor Driver IC
 Multi-channel PMIC
- 3) Automotive SoC
 USB Type-C PD Charger IC
 Head Lamp LED Driver IC

차별성 및 혁신성

- 1) Analog IP & PMIC 전문 Fabless
- 2) 국내외 안정적 SCM 능력 확보
- 3) Analog IC 고경력 설계, 개발인력 및
 삼성전자 System LSI 출신 경영진

TU 복리후생제도

 건강검진 지원 (2인)	 식사 및 스낵바 제공	 경조사 지원	 선택적복리후생 (체력단련, 자기개발 등)
 특허 보상금 (출원 50만원/ 등록 100만원, 200만원)	 콘도 회원권 운영	 장기근속 포상 및 휴가 (만 5년↑ 300만원)	 사내 대출 제도

신입 및 경력직원 채용 공고

Analog 회로 설계	Digital 회로 설계	Application Engineer
담당업무 - CMOS Analog circuit design - HSPICE & Spectre 사용 가능자 - Layout 설계 또는 설계 guide 가능한 자 - 회로 불량분석 및 양산 경험자 유경험자 우대 - ADC, DAC, PLL, OSC, DCDC, LDO, LVDS, PWM 등등 상기 언급된 IP 중 유경험자 지원자격 - 경력 : 신입 ~ 10년 - 기타 필수 사항 우대사항 - 전기/전자, 컴퓨터/시스템공학 - 해당직무 근무경험 - 석사학위, 박사학위 수여자 - 유관업무 경력자 - 인근거주자 - 즉시출근 가능자 - 장기근무 가능자	담당업무 - ASIC 설계 유경험자, RTL coding , MCU 제품개발, FPGA Handle, ASIC 제품개발 유경험자 우대 - TOP integration 경력자 - Sensor I/F: DSP (Digital filter, AFE control logic, external I/F) - MCU (ARM Cortex-M0/M3을 embed 한 mixed-IC 설계) - 기타 mixed-signal IC 용 control logic 설계 지원자격 - 경력 : 신입 ~ 10년 - 기타 필수 사항 우대사항 - 전기/전자, 컴퓨터/시스템공학 - 해당직무 근무경험 - 석사학위, 박사학위 수여자 - 유관업무 경력자 - 인근거주자 - 즉시출근 가능자 - 장기근무 가능자	담당업무 - 반도체 IC 평가용 PCB 설계 및 검증 - MCU Control F/W 개발 - 계측 장비를 통한 반도체 검증 및 평가 - Final TEST Setup - TEST Yield 관리 및 개선 지원자격 - 경력 : 신입 ~ 5년 - 기타 필수 사항 우대사항 - 전기/전자, 컴퓨터/시스템공학 - PADs 및 OrCAD 경험자 - 반도체 양산 관리 경험자 - Labview 경험자 - 해당직무 근무경험 - 유관업무 경력자 - 즉시출근 가능자 - 장기근무 가능자

채용담당자 : 강남이 부장 / 031-203-9351 / nykang@techwidu.com

30

(주) 텔레칩스

Telechips

www.telechips.com

국내 시스템 반도체의 Leading Company 로
중국, 일본, 싱가포르, 유럽 등에 지사를 보유한 Global Company!
"Change by Challenge and Cooperation!"

텔레칩스는?

국내 차량용 반도체 No.1, 비메모리 반도체 국내 중소 팹리스 1 위기업

1999 년에 설립된 텔레칩스는 현재 현대기아차 점유율이 80%이상, Car Infotainment 세계시장 점유율은 12.4%입니다. 그 외 차량용 반도체 시장에서 연간 1500 만 개 이상의 제품을 판매하고 있으며, 수십개의 대규모 협력사와 지속적으로 거래하고 있습니다.

34.3%에 달하는 업계 최고의 연구개발 투자

현재의 성과에 만족하지 않고 Cockpit, ADAS 등 첨단 운전자 보조기술 상용화와 인공지능(AI) 기반의 차세대 지능형 반도체 개발하고자 업계 최고수준으로 연구개발에 투자하고 있습니다. 그 결과 총 153 개의 국내외 핵심전략 기술 관련 특허와 차량용 반도체 원천기술을 보유하고 있으며, 국내외 협력 네트워크를 300 개 이상 보유하고 있습니다.

문화 • 복지는?

모두가 같은 직급인 수평적 조직 • 공동성장을 추구하는 도전 & 협력문화

텔레칩스가 꿈꾸는 것을 도전하고 실제로 만들어내는 힘은 바로 텔레칩스의 우수한 인재들입니다. 그러한 인적자원의 중요성을 그 누구보다 잘 알고 있기에 구성원들이 자신의 역량을 충분하게 발휘하고 계발하고 또 즐겁게 일할 수 있도록 구성원 간의 존중과 배려를

기반으로 **수평문화**를 지향합니다. 이를 통해 **협력**과 **도전분위기**를 이끌어내며, 지속적인 성장을 만들어냅니다.

PS & PI 보상제도 • 워라벨 중시

‘**기본 연봉 + PI(Productivity Incentive: 최대 연봉의 30%) + PS(Profit Sharing)**’로 구성된 보상제도를 운영함으로써 회사의 경영실적을 기반으로 직원들과 최대한 이익을 나누고 있습니다. 복지에 있어서도 인재들이 마음껏 재능을 발휘하고 도전하면서 즐거움과 행복을 느낄 수 있도록 ‘**Work-Life Balance**’, ‘**Financial Aid**’, ‘**Fun Office Life**’과 같은 영역에서 모든 지원을 아낌없이 투자하고 있습니다.

텔레칩스 대표 복지제도 소개

WORK-LIFE BALANCE	FINANCIAL AID	FUN-OFFICE LIFE
 완전 선택적 근로시간제 자유로운 출퇴근 시간으로 업무효율 극대화 및 삶의 질 향상을 추구합니다.	 대기업 수준의 임금정책 대기업 수준의 높은 임금정책을 운영하고 있어 동기부여를 추진하고 있습니다. (신입사원급 연간 총 근로소득 수준 : 약 5천만원)	 PC/Laptop 자율선택 입사시 본인이 희망하는 PC/Laptop 선택 가능합니다.
 정기 유급휴가 5일 추가 제공 연차와 별개로 자유롭게 사용할 수 있는 5일의 정기휴가를 1년마다 추가로 드립니다.	 사원대여금 제도 총 5천만원까지 대여가 가능하며, 3천만원까지 무이자로 추가 2,000만원까지는 저금리(2%) 이자로 주택 취득 자금을 지원하고 있습니다.	 사내 카페 이용 및 무료 조식 제공 사내카페에서 음료와 간식, 조식을 제공하고 있으며, 석식은 별도 식대를 지원합니다.
 장기근속 휴가 제공 5년 근무 시 휴가 4일과 휴가비 100만원, 10년 근무 시 휴가 6일과 휴가비 500만원을 지원하고 있습니다.	 주택(기숙사) 지원 월도 2시간 이상 소요되는 수도권 이외 거주 임직원을 위하여 사택을 지원하고 있습니다.	 사내 동호회 활동 지원 동호회 활동으로 직원들과 취미 공유가 가능합니다.
 프리미엄 콘도 및 호텔 지원 서울 남대문 코트야드 메리어트 호텔과 함께 대명 리조트 콘도를 <u>노블리안</u> 등급까지 이용 가능합니다.	 정기 건강검진 지원 당사와 <u>협약된</u> 최고의 의료 시설에서 무료 정기 건강검진을 받으실 수 있도록 지원하고 있습니다.	 사내 휴식공간 제공 업무시간에도 수면실과 안마의자 휴식이 가능합니다.
 Mother Box 제공 임직원 본인 및 배우자 임신 시 육아물품을 지원을 통해 출산을 축하하고 장려합니다.	 단체보험 지원 사고에 대한 임직원의 경제적 손실 최소화를 위하여 단체보험을 지원하고 있습니다.	 자율복장 제도 자신에게 맞는 최적의 복장으로 근무할 수 있습니다.
 초등학교 입학 축하 선물 제공 임직원 자녀의 초등학교 입학 축하하며, 입학 시 필요한 문구 등 선물을 제공합니다.	 독감 예방주사 지원 임직원의 안전한 회사 및 가정생활을 위하여 독감 예방접종 비용을 지원하고 있습니다.	 생일자 선물 제공 생일을 맞이한 임직원에게 상품권을 제공합니다.
		 Hof Day & Catering 서비스 제공 전 임직원이 소통할 수 있는 이벤트를 진행합니다.

※ 채용담당 : 공병훈 팀장/ 02-6312-1114/ james.gong@telechips.com

파이칩스는 자사의 무선통신 핵심반도체 원천기술을 기반으로 RFID 리더용 초소형&저전력 반도체 칩(SoC)과 RFID 모듈, 그리고 안테나를 전 세계 주요 RFID 업체에 공급하고 있습니다. RFID 솔루션 구축에 요구되는 필수 구성요소들을 턴키(turn-key)로 공급하면서, 고객사의 개발기간 및 비용 단축과 더불어 최적화된 성능을 낼 수 있도록 풍부한 경험의 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어들의 전문적인 기술지원이 가능합니다.

이를 바탕으로 저전력 및 근거리인식 응용분야와 사물인터넷 응용분야에서 확실한 우위를 선점하고 있으며, 타사솔루션 대비 가격 경쟁력을 바탕으로 고객사와의 상생을 표방하고 있습니다.

1

전세계 유일한 RFID SoC

Flash memory, MCU, RF, MODEM이 하나의 칩에 내장됨

2

저전력/고성능 cost-effective 리더 솔루션

인식거리가 짧고 태그수가 적은 응용분야에서 최고의 가격 대 성능비

3

강력하고 유연한 소프트웨어 지원 정책

고객사 요청에 따른 커스터마이징

산학협력을 통한 개방형 혁신

- 요소기술을 가진 대학 연구실과 꾸준한 산학협력 진행

R&D 중심의 기술벤처

- 지속적인 CMOS RF SoC 개발 및 상용화
- 부설연구소 인력의 60% 석사 이상
- SoC 를 위한 모든 요소기술 보유
- 관련 특허 : 등록 37건, 출원 2건

축적된 기술&경험

- 10년 이상 RFID 분야에 꾸준한 투자
- 지속적인 성능개선 및 보완

주요제품 및 특징점

RAIN RFID Reader/Writer Chip_**PR9200**



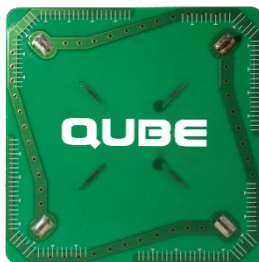
- RF, MODEM, MCU, PA, Memory가 통합된 RAIN RFID Reader SoC
- ISO18000-6C, EPC Global Gen2 protocol 지원
- 64pin 6mm x 6mm FBGA 패키지
- 별도의 외부 MCU나 메모리를 추가하지 않고 리더 구성 가능

RAIN RFID Reader/Writer Module_**RED**



- RAIN RFID Reader SoC PR9200을 기반으로 설계된 모듈 제품
- 작은 크기와 우수한 성능의 RFID 리더를 개발하는데 적합
- 제품 크기: 24x24x3(mm)
- 출력: 27dBm Max.(13~27dBm)
- 개발 기간을 현저히 단축하여 빠르게 시장 대응

RAIN RFID Reader/Writer Antenna_**QUBE**



- Quadrifilar helical antenna, Power dividing 등 차별화된 기술이 적용된 고성능 안테나
- 제품 크기: 40x40x10, 60x60x10, 60x60x15(mm)
- 중장거리(~5m) UHF RFID Application에 최적화된 성능을 제공
- 케이블 및 커넥터 customizing 가능
- 기구설계 가이드 제공

※ 채용 담당자 : 황혜란 차장/ 042-860-0046/ hrhwang@phychips.com

Developing Camera SoC Products for Better Quality of Life, based on Philosophy

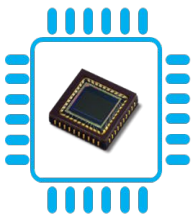
“Innovating Human Life with Our Imaging Technology”

PIXELPLUS is a Fabless Semiconductor Company that researchers, develops and manufactures Image Sensors and Imaging Solutions. Image Sensors and Imaging Solutions hold a promising market growth potential since they can be widely applied and adopted in diverse industries and fields including automotive, security, medical and bioscience. PIXELPLUS has been focusing on Automotive Camera Solutions and Security and Monitoring Camera Solutions.

PIXELPLUS offers Total Solutions for Image Sensor-based Camera Applications by penetrating Medical and Home Application markets in the future.



“Total Camera Solution Provider”

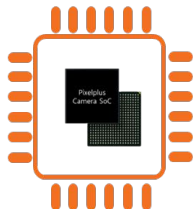


PIXELPLUS sensor products are reliable and highly scalable solution with industry-verified market leadership.

Analog CIS

Digital CIS

- Proven in many industries
- Cost competitive with one chip solution
- Companion IC friendly



PIXELPLUS has various companion chip also can provide customized SoC solution.

Companion Chip

System On Chip

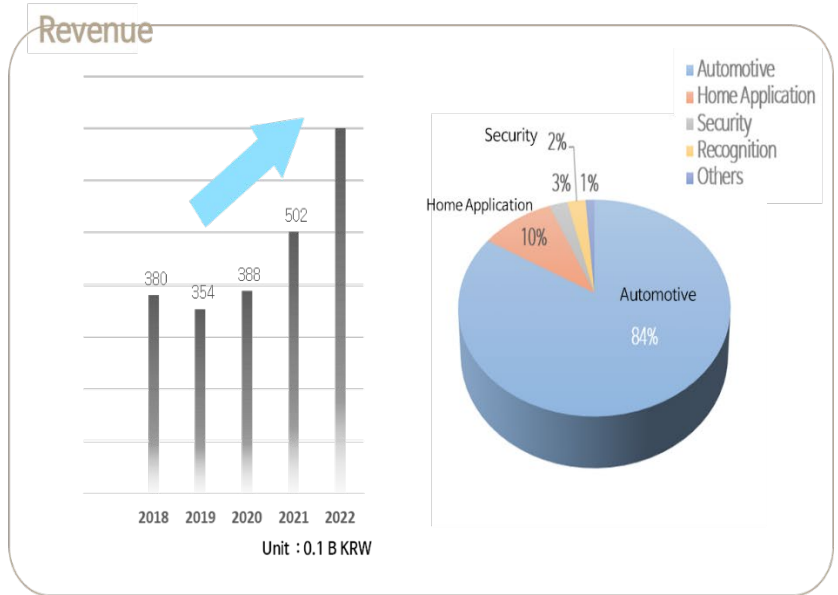
- Diverse, differentiated, integrated solution
- Optimized for image sensors
- Cost competitive



- 이미지 센서의 원천기술 개발 능력을 자체적으로 보유 (Pixel Design, Analog Design)
- 영상처리 알고리즘에 대한 원천기술 보유 (Image Signal Processor, HDR, LFM etc.)
- 센서부터 ISP, SERDES, SoC 에 이르기까지 영상처리 Total Camera Solution 구축



〈신규사옥 조감도〉



◆ 일반현황

- 주소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105(이의동, 경기알앤디비센터 6 층)
- 판교제 2 테크노밸리 신규사옥으로 이전예정(2023 년)
- 사업분야 : 이미지센서를 전문으로 연구개발하고 생산하는 Fabless 전문업체
- 채용담당자 : 경영지원본부 최일석 본부장 031-888-5323

인사총무팀 진병석 팀장 031-888-5322

기업 소개

저희 하이딥은 2010년에 설립된 Fabless design 회사이며 2022년 코스닥 상장사입니다.

On-cell Flexible OLED 디스플레이를 사용하는 Premium 레벨의 Global 스마트폰, 스마트워치, 태블릿 제품을 목표 시장으로 합니다. 연간 약 18.8 억대 규모의 거대 시장이고, 2024년 스마트폰용으로만 약 8억대가 적용 예상되는 OLED 디스플레이에 대한 혁신적인 Touch 및 Stylus용 플랫폼 솔루션을 개발하고 있습니다.

현재 글로벌 Top-tier 모바일기기 제조사들과 디스플레이 제조사들과 Co-work 하여 Touch와 Stylus 지원용 IC를 디자인하며, 제품 적용을 위한 알고리즘, 센서, 스타일러스 뿐 아니라 UI/UX까지 타 Fabless design 회사들과는 달리 분명한 차별성을 가지는 독자 기술 솔루션을 확보하기 위해 필요한 전체 기술을 개발하는데 역량을 집중하고 있고 이외 기술 분야를 넓혀 나가기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

2014년 1mm conductive stylus 기술을 최초로 Lenovo 태블릿 모델 등에서 상용화 성공하였고, 2015년 Apple 보다 먼저 3D Force Touch 기술을 Huawei 스마트폰 모델들에 적용시켜 양산 성공하였으며, 2021년 On-cell flexible OLED 디스플레이를 적용 시작한 Samsung의 스마트워치에서 안정적인 터치 기술을 양산 성공하였습니다. 그리고 또 한번 세상에 없던 기술 솔루션 개발을 진행하고 있습니다.

전 세계 대상으로 최고의 기술 경쟁력 확보가 하이딥의 변함없는 최우선 목표입니다.

하이딥의 인재상

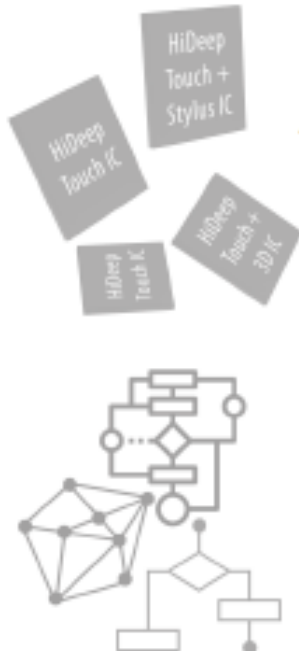
긍정적이고 열정적인 자세, 문제 해결에 대한 적극적인 자세, 평범한 일상에 안주하지 않고 끊임없는 성장을 원하는 분.

하이딥?

국가대표 반도체IC 설계회사

세상에 없던.
가능하리라 상상하지 않았던.
누구도 성공하지 못한.
비밀병기 설계 중.
지금 탑승하세요.

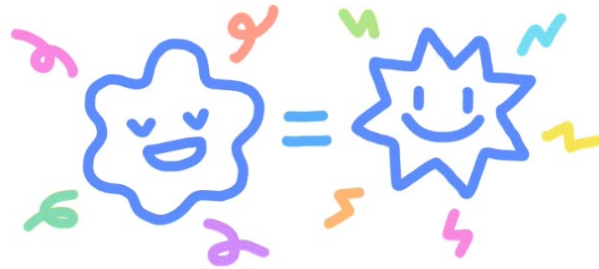
내가 설계한 IC가 수천만개 양산되어
세계 프리미엄 제품들에 탑재되는 짜릿한 경험을 드립니다.



구분	모집 부문	자격 요건
연구소	Software Engineer	- C / C++ / C# programming 가능자 - Algorithm / Firmware programming 가능자
	Analog IC Designer	Analog IP 설계 가능자
	Digital IC Designer	VLSI / SOC / Memory 설계 가능자
	Hardware Engineer	회로이론 및 전자공학에 대한 기본적인 이해
	Layout Engineer	Analog layout, Digital P&R 가능자
	공통	긍정적이고 열정적인 자세, 문제 해결에 대한 적극적인 자세 평범한 일상에 만족하지 않고 끊임없는 성장을 원하는 분
지원자격	전자공학 및 관련 전공자, 학사/석사 졸업생(경력자도 가능), 졸업예정자 병역특례: 전문연구요원 대상자(석사이상), 사회복무요원 소집대상자(학사)	
접수	이력서 email 접수: mariana.kim@hideep.com www.hideep.com	

※ 채용담당자 : 김경영 부장/ 031-717-5775/ mariana.kim@hideep.com

안녕하세요, 사이언티픽아날로그랩스 입니다.



Make Analog IC Design as Systematic and Productive as Digital

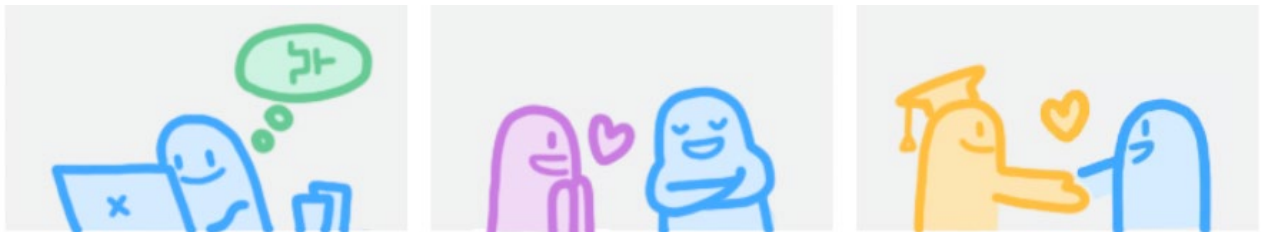
사이언티픽아날로그랩스는 아날로그 IC도 디지털 IC처럼 쉽고 체계적인 방법으로 설계할 수 있다는 신념을 가지고 설립한 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 Scientific Analog의 한국법인입니다. 서울시 서초구 남부터미널역 근처에 위치하고 있습니다.

오늘날 설계되는 시스템-온-칩(SoC)들은 그 회로의 대부분이 디지털 회로로 구성되어 있기에 검증 또한 디지털 환경에서 수행되고 있지만, 필수적으로 함께 포함되는 아날로그 회로들 때문에 칩 전체의 검증을 하는데 어려움이 많고, 뒤늦게 발견한 사소한 오류 때문에 개발한 제품의 시장 진입이 지연되는 경우가 많습니다.

Scientific Analog는 바로 이러한 문제를 해결하기 위해서, 아날로그 회로들을 기존의 디지털 검증환경 상에서 모델링하고 시뮬레이션할 수 있는 EDA 소프트웨어 툴인 **XMODEL**, **GLISTER**, **MODELZEN**을 개발하였습니다. 그리고 이들을 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 다수의 반도체 설계 회사들에서 실제 제품 검증에 활발히 사용 중입니다.



- **XMODEL:** 디지털과 아날로그 회로가 섞여있는 SoC 검증을 효과적으로 수행할 수 있도록, 기존의 디지털 검증환경인 SystemVerilog 상에서 아날로그 회로의 모델을 빠르고 정확하게 시뮬레이션할 수 있게 해주는 확장솔루션입니다.
- **GLISTER:** SystemVerilog 코딩에 익숙하지 않은 아날로그 설계자들도 보다 친숙한 환경인 Cadence Virtuoso 환경에서 아날로그 회로의 모델들을 schematic 형태로 쉽게 작성하고, 시뮬레이션을 수행할 수 있게 해주는 GUI 환경입니다.
- **MODELZEN:** 이미 설계가 완료된 아날로그 회로로부터 SystemVerilog 모델을 자동으로 생성하여, SPICE보다 10배 이상 빠른 시뮬레이션을 디지털 검증환경에서 수행할 수 있게 해주는 모델생성툴입니다.



사이언티픽아날로그랩스에서는 IC 설계자와 검증자들이 XMODEL, GLISTER, MODELZEN을 효과적으로 사용할 수 있도록, **다양한 아날로그/혼성신호 회로의 모델 예제들을 개발**하고, 그 경험을 바탕으로 **국내외 고객사에 전문적인 기술지원을 제공**할 수 있는 **아날로그/혼성신호 모델개발자**를 상시 모집중입니다.

아날로그/혼성신호 모델개발자가 되면, IC 설계 경험이 풍부하지 않아도, 다양한 회로 분야에서의 전문성을 단기간에 키우면서, 아날로그/혼성신호 검증이라는 떠오르는 분야의 글로벌 스페셜리스트가 될 수 있습니다.

- 최신 업계 표준 및 저명 학술 논문들을 읽고, 다양한 아날로그/혼성신호 회로들의 모델들을 개발하면서 전문지식을 쌓을 수 있습니다.
- 국내 대기업들의 설계 및 검증 엔지니어들과 소통하면서 차세대 제품들에 적용된 설계 기술들의 효과적 검증을 위한 방법을 함께 고민할 수 있습니다.
- 국내 명문 대학 연구실들과 협력하면서 IC 설계분야의 교수, 석박사 연구원들과 인적 네트워크를 쌓을 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 웹사이트 www.scianalog.com/careers 를 참고해주세요.

※ 채용담당자 : 황민하 팀장/ 070-7847-9524/ careers@scianalog.com

하만커넥티드 서비스즈인크



<http://www.harman.com>



하만에 대해서

하만은 2017년 삼성전자의 인수합병으로 100% 자회사로 편입되었습니다.

하만은 커넥티드 카 시스템, 음향/영상기기, 기업 자동화 솔루션 및 커넥티드 서비스 등을 자동차 회사를 비롯한 일반 기업 및 소비자에게 개발하여 공급합니다. 우리의 인재들과 혁신적인 추진력으로 커넥티드 카, 기업의 연결성, 그리고 연결된 삶은 통하여 풍부한 경험을 가능하게 함으로서 가치를 창조해내고 있습니다.

모든 세대의 음향애호가들은 하만의 제품이 스튜디오나 무대에서, 가정에서나, 휴대 중에도 최고의 음향을 들려주기에 우리의 제품을 선호합니다. HARMAN의 대표적인 브랜드로는 AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson®, Revel®등이 있으며, 전 세계 5천만 대 이상의 자동차에 HARMAN의 카오디오와 인포테인먼트 시스템이 적용되고 있어 향상된 운전 경험을 제공하고 있습니다. 우리는 이와 같은 혁신의 정신을 세계 유수의 공연장 및 스포츠 경기장에도 적용하여 모든 사람에게 가정에서와 같은 최상의 음향 경험을 제공하고 있습니다.

글로벌 시장에서 다양한 기회를 잡기 위해서는 전설적인 사운드 이상의 것이 요구되고 있습니다. 하만은 빠르게 변화하는 세계정세에 대응하기 위해 우리의 조직과 비용 구조를 재구성하고 고도로 통합되고 완벽한 소프트웨어가 탑재된 제품과 서비스 제공이 중요하다는 것을 인지하고 있습니다. 가장 중요한 것은 60년 이상 HARMAN과 HARMAN의 오디오 브랜드들, 그리고 인포테인먼트 기술들을 차별화시켰던 혁신의 기록들이 계속되고 있다는 것입니다.

하만 DTS 코리아에 대해서

Digital Transformation Solutions (DTS)는 하만의 전략 사업부로 고객들의 세상을 연결하는데 도움을 주는 디지털 변환, 소프트웨어 개발 역량을 보유하고 있습니다.

이 중 DTS 코리아는 반도체 디자인의 R&D 센터에 특화된 지부입니다. 삼성전자의 자회사이자 파트너로 AP, 전장 그리고 다른 제품들에 적용되는 10 나노미터 이하의 고부가 제품에 대한 풍부한 전문지식 및 노하우를 보유하고 있습니다.

RTL, 검증, 프론트 엔드와 백엔드 그리고 포스트 실리콘 검증 등 전체적인 실리콘 디자인서비스를 서포트 할 수 있습니다.

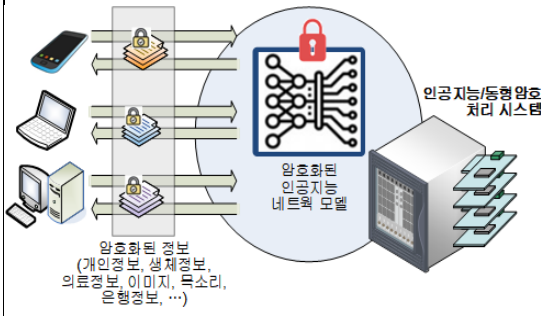
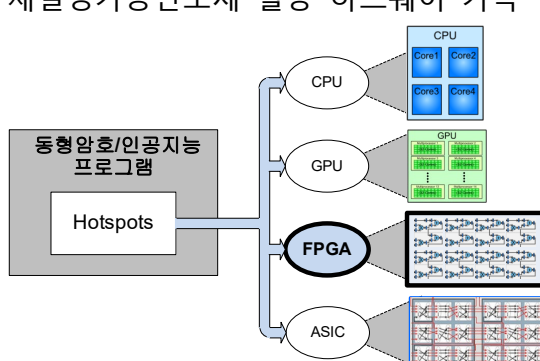
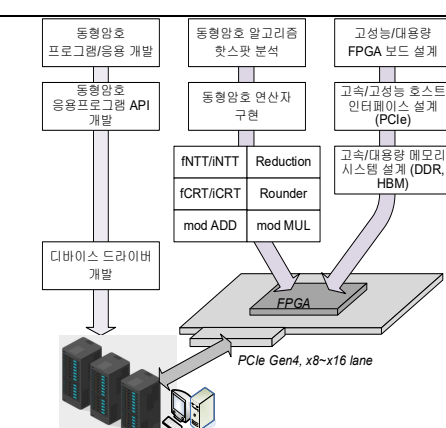
하만 DTS 코리아는 RTL 설계, Pre-silicon 검증, DFT, Front-end 와 Back-end 등 반도체 설계 및 개발 솔루션을 제안합니다.

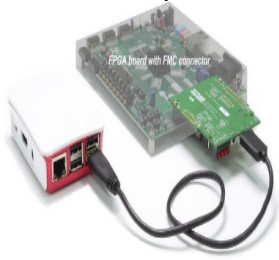
특히, 하이엔드 제품에 대한 다양한 경험을 바탕으로 다양한 시스템 반도체를 효율적으로 검증하고 설계 개발할 수 있는 역량을 가지고 있습니다.

더하여, DTS 코리아는 전문적인 Verilog, UVM, UVMA 엔지니어 경험 및 커리큘럼으로 검증 컨설팅 또한 진행하고 있습니다. 설계 역량과 인재에 대한 분석을 통하여 효율적인 검증 컨설팅을 제안합니다.

RTL Design & Verification FPGA, Verilog, UVM(Universal Verification Methodology)을 통한 RTL 설계 및 검증 CPU 및 NOC (Network on Chip) 기반의 Bus를 활용한 SoC 개발	DFT SCAN, MBIST 등을 구현을 통해 신뢰성과 양산성을 갖춘 SoC를 개발 표준기반 테스트 방법을 통해 다양한 IP에 맞는 Interface 테스트 방법 설계	Physical Implementation SoC에 대한 최적의 Process와 Design Flow, Signoff Methodology를 개발 및 구현 개발 SoC에 적합한 Logic level 구현 및 Complex clock 구조에 따른 Timing Methodology 구현	Physical Design Physical Level 구현 (Floorplan, Placement, CTS, Routing) 및 검증 Physical Verification 및 SI/PI/EM 분석을 통해 신뢰성 있는 SoC를 구현
Post Silicon Validation IC에 대한 보드 실장 후 성능 검증 소프트웨어 셋업 및 실행, 이후 발생하는 문제에 대한 디버깅 및 분석 수행	Verification Consultant 고객의 제품 및 환경을 기반으로 효율적 설계/검증 방법 컨설팅 제공 Automotive Safety에 대한 컨설팅 제공		

※ 채용담당자 : 심홍렬 대리/ 031-8016-6506/ resumehcskr@harman.com

회사명	(주)퓨처디자인시스템 (Future Design Systems)		
주소	대전시 유성구 유성대로 593, 대덕테크비즈센터 504호		
홈페이지	http://www.future-ds.com	https://github.com/github-fds	
설립일	2017.05.17	구성원	4명 (대표이사 포함)
대표자	기안도 (Ando Ki)	연락처	adki@future-ds.com / 010-3843-6937
비전	계산가속으로 세상의 문제들을 빠르게 해결하여 산업발전과 인류복지에 기여한다. 		
시장	동형암호와 인공지능 (암호화된 데이터를 복호화 없이 연산할 수 있는 기술) - Outsourcing Computation - Privately - Anonymous data processing - Short-term identity - Genomics, Health, National Security, Education, Social security, Business analytics, Cloud computing 		
기술	재설정가능반도체 활용 하드웨어 가속  		

제품현황	High-end for server computer  http://www.future-ds.com/en/products.html#DeepAccel-DualVU9P	Mid-range for desktop PC  http://www.future-ds.com/en/products.html#DeepAccel	Low-end for single-board computer  http://www.future-ds.com/en/products.html#CON_FMC
------	--	---	---

※ 채용담당자 : 서성원 부사장/ 042-864-0211/ swseo@future-ds.com

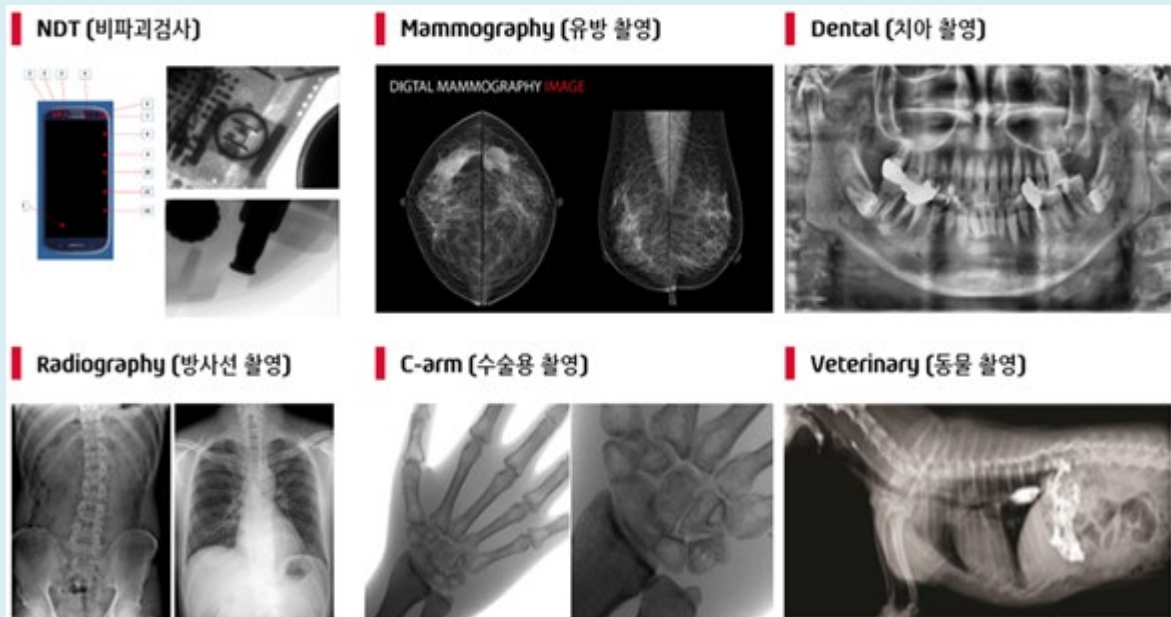
◎ 회사정보



- 설립/기업공개일: '11.05.02 / '16.04.11
- 임직원 수: 230명
- 매출액(21년): 1,106억원
- 주요제품: 디지털 엑스레이 디텍터 외
- 소재지: 경기도 화성시 삼성1로1길14
- 홈페이지 주소: <https://www.rayence.com>

◎ 회사소개 및 주요사업

- 디지털 엑스레이 디텍터 제조 및 이미징 솔루션 전문 기업
- TFT, CMOS 디텍터 핵심 기술을 내재화한 풀라인업 제조 기업
- 엑스레이 응용 분야 국내 최대, 구강 內 센서 세계 시장 점유율 1위 기업



◎ 주요연혁

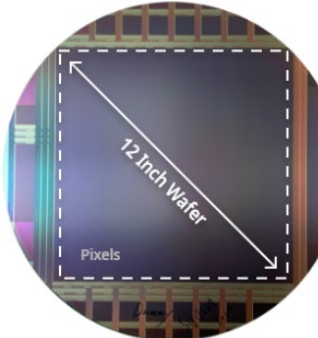
'07	11월 - 삼성과 디지털 X-ray 디텍터 공동 개발	'16	4월 - 코스닥 상장 6월 - World Class300 선정
'11	5월 - 레이언스 설립 10월 - 세계최초 CMOS 기반의 유방암 진단기기 론칭	'17	5월 - If 디자인, IDEA 디자인 수상 - ICT Multi-Media Technology 수상 - 치과용 센서 업계 최초로 100만 달러 수출 기록
'12	10월 - CMOS 디텍터 전문 기업 휴먼레이 12월 - 제49회 무역의 날 천만불 수출의 탑	'18	12월 - Med Tech 10대 이미징 솔루션 기업 선정
'13	6월 - GE Healthcare와 파트너쉽 체결 10월 - 자체 기술로 X-ray TFT 디텍터 개발 12월 - X-ray TFT 디텍터 세계 일류 상품 선정 - 제50회 무역의 날 이천만불 수출의 탑	'19	4월 - 산업용 IGZO TFT, Aero Sensor In/Off Line AXI, Portable 제품 출시 12월 - 제 56회 무역의 날 칠천만불 수출의 탑
'14	11월 - 대한민국 기술대상(은상): 유방진단 고해상도 CMOS 디텍터 기술 수상 12월 - I/O센서, 세계 일류 상품 선정	'20	12월 - IR52 장영실상(치과용 벤더블 X선 센서, EzSensor Soft) 수상
'15	04월 - 세계 최초 구부러지는 I/O센서 개발 12월 - 제52회 무역의 날 오천만불 수출의 탑	'21	4월 - 2021 대한민국 ImpaCT-ech대상: 세계 최초 대면적 CMOS X선 검출기 'MIDAS2121' 수상

◎ 최근 연구 성과

[IEEE2020 Journal of Solid-State Circuit]



A 5.2-Mpixel 88.4-dB DR 12-inch CMOS X-ray Detector with 16-bit Column-Parallel Continuous-Time Incremental A/Ds, DOI: 10.1109/jssc.2020.3077967



12-Inch Wafer
Pixels
Readouts & IOs



ISSCC 학회 고화질 디텍터 기술 논문 발표



IEEE Journal of Solid-State Circuit

◎ (공고) Analog 설계 엔지니어 인력 채용

담당업무	우대사항
· AFE(Analog Front End) 설계 · Decoder, Readout 회로 설계 · CIS(CMOS Image Sensor) Full CHIP 설계 · 설계 문서, 결과물 산출 관리 외	· Hspice, Spectre 활용 경험 · Virtuoso, Calibre 활용 경험 · 회로불량 분석, 양산 경험 · Layout 설계 및 Guide 가능

◎ 직원혜택 및 복지제도

· 국내 최고 수준의 직장 어린이집 · 헬스, 스크린 골프, 요가, 필라테스 등 건강한 몸과 마음을 위한 피트니스 센터 · 건강을 최우선으로 생각하는 식당 및 카페테리아 · 기타 복리후생 제도운영(기숙사 지원, 직원 주택자금대출, 자녀학자금지원, 경조사지원 등)

※ 채용담당자 : 이민혜 담당/ 031-8015-6330 / minhyae.lee@rayence.com



반도체설계교육센터
IC DESIGN EDUCATION CENTER

academy.idec.or.kr
www.idec.or.kr

